

SEIN

Inhalt

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 2007

- 04 Tagesordnung
- 09 Berichte des Vorstands
- 12 Teilnahme an der Hauptversammlung
- 14 Hinweise

GESCHÄFTSBERICHT 2006 KURZFASSUNG

- 16 Überblick
- 17 Brief an unsere Aktionäre
- 22 Konzernlagebericht | Auszug
 - 22 Geschäft und Rahmenbedingungen
 - 32 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage | Auszug
 - 35 Prognosebericht
- 38 Konzernabschluss | Auszug

Tagesordnung auf einen Blick

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2006, des Lageberichts des Vorstands für die ELMOS Semiconductor AG und des Lageberichts für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien (10% des Grundkapitals)
7. Beschlussfassung über eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, die Schaffung bedingten Kapitals und die entsprechende Satzungsänderung (75 Mio. Euro max. Gesamtnennbetrag, 5 Mio. Euro max. Ant. Grundkapital)
9. Beschlussfassung über die Änderung von §14 der Satzung (Bekanntmachungen)

Einladung zur 8. Ordentlichen Hauptversammlung der ELMOS Semiconductor AG, 44227 Dortmund
(ISIN DE0005677108/Wertpapier-Kenn-Nummer: 567 710)

Sehr geehrte Aktionäre,

unsere 8. Ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, den 10.05.2007, um 10.00 Uhr im Casino Hohensyburg, Dortmund, Hohensyburgstrasse 200, 44265 Dortmund, statt.

Tagesordnung

1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2006, des Lageberichts des Vorstands für die ELMOS Semiconductor AG und des Lageberichts für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den bei der ELMOS Semiconductor AG ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2006 in Höhe von 44.937.751,06 Euro vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.

3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu bestellen.

6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2006 wurde der Vorstand ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Diese Ermächtigung ist bis zum 18.11.2007 befristet. Es wird vorgeschlagen, diesen Beschluss aufzuheben und den Vorstand erneut zum Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft zu ermächtigen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

- a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 09.11.2008 eigene Aktien zu erwerben.
- b) Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Aktien, auf die ein Anteil am Grundkapital in Höhe von bis zu insgesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals entfällt, beschränkt. Die Ermächtigung kann ganz oder in mehreren Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke im Rahmen der vorgenannten Beschränkung ausgeübt werden.
- c) Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebotes.
 - ▶ Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Eröffnungskurs am Erwerbstag im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main um nicht mehr als zehn Prozent über- oder unterschreiten.
 - ▶ Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Schlussauktionspreise im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleich-

- baren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main während der letzten drei Börsentage vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebotes um nicht mehr als zehn Prozent über- oder unterschreiten. Das Volumen des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die gesamte Zeichnung des Angebots dieses Volumen überschreitet, muss die Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär der Gesellschaft kann vorgesehen werden.
- d) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworben werden, zu den nachfolgenden Zwecken zu verwenden:
- aa) Sie können an Führungskräfte und Mitarbeiter der ELMOS Semiconductor AG sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Mitarbeiter verbundener Unternehmen im Rahmen der Aktienoptionspläne 1999 und 2004 in Erfüllung der Aktienbezugsrechte übertragen werden. Soweit eigene Aktien Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft in diesem Rahmen übertragen werden sollen, wird der Aufsichtsrat der Gesellschaft hierzu ermächtigt. Dabei werden die Regelungen der bestehenden Aktienoptionspläne 1999 und 2004 angewandt: Die von der Hauptversammlung beschlossenen Eckpunkte der Aktienoptionspläne 1999 und 2004 liegen als Bestandteile der notariellen Niederschriften über die entsprechenden Hauptversammlungen bei dem Handelsregister in Dortmund zur Einsicht aus. Sie können außerdem in den Geschäftsräumen und am Sitz der ELMOS Semiconductor AG, Heinrich-Hertz-Str. 1, 44227 Dortmund, sowie im Internet unter http://www.elmos.de/ir/corporate_governance/options/index.html eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt und werden während der Hauptversammlung ausliegen.
- bb) Sie können gegen Sachleistung veräußert werden, insbesondere um sie Dritten beim Zusammenschluss mit Unternehmen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder anderen Wirtschaftsgütern anzubieten.
- cc) Sie können Führungskräften und Mitarbeitern der ELMOS Semiconductor AG, Mitgliedern der Geschäftsführungen und Mitarbeitern verbundener Unternehmen und freien Mitarbeitern zum Erwerb angeboten und übertragen werden.
- dd) Sie können durch den Aufsichtsrat den Mitgliedern des Vorstands der ELMOS Semiconductor AG unter Wahrung des Gebots der Angemessenheit der Vergütung (§87 Abs. 1 AktG) als aktienbasierter Vergütungsbestandteil zugesagt und übertragen werden. Die Einzelheiten der aktienbasierten Vergütung für die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat festgelegt.
- ee) Sie können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Verfahren, ist der Vorstand ermächtigt, die Zahl der Stückaktien in der Satzung anzupassen.
- e) Ein Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen, als diese Aktien gem. den Ermächtigungen in lit. d), aa), bb), cc) und dd) verwendet werden.
- f) Die auf der Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.05.2006 bestehende und bis zum 18.11.2007 befristete Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben.

7 Beschlussfassung über eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Herr Herbert Sporea, Altwittenbek, hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 31.12.2006 niedergelegt. Das Amtsgericht Dortmund hat auf Antrag des Vorstands der ELMOS Semiconductor AG gemäß §104 Abs. 2 AktG Herrn Dr. Klaus G. Weyer bis zur Beendigung dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt.

Da die Amtszeit des gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieds mit dem Ablauf dieser Hauptversammlung endet, schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor,

Herrn Dr. Klaus G. Weyer
Schwerte
ehemaliges Vorstandsmitglied der
ELMOS Semiconductor AG
Mitglied des Aufsichtsrats der Paragon AG
Mitglied des MST Projektbeirats Dortmund

gemäß §6.3 der Satzung für die verbleibende Amtszeit des ausgeschiedenen Herrn Herbert Sporea bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2010 in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§96 Absatz 1, 101 Abs. 1 AktG sowie §6.1 der Satzung nur aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen.

8 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, die Schaffung bedingten Kapitals und die entsprechende Satzungsänderung

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2002 über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen wird aufgehoben. Es wird folgender neuer Beschluss gefasst:

- a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 09.05.2012 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder Namen lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 75 Mio. Euro mit einer Laufzeit von längstens 10 Jah-

ren zu begeben und den Inhabern von Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte bzw. den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von insgesamt bis zu 5 Mio. Euro nach näherer Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen zu gewähren.

Die Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen können außer in Euro auch in der gesetzlichen Währung eines OECD-Staates – unter Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert von maximal 75 Mio. Euro begeben werden.

Die Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen können auch durch 100%ige unmittelbare oder mittelbare inländische oder ausländische Beteiligungsgesellschaften der ELMOS Semiconductor AG begeben werden; in diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Beteiligungsgesellschaft die Garantie für die Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern von Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte bzw. den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der ELMOS Semiconductor AG zu gewähren.

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere von der ELMOS Semiconductor AG ausgestellte Optionsscheine beigelegt, die den Inhaber nach Maßgabe der vom Vorstand näher festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von neuen Aktien der ELMOS Semiconductor AG berechtigen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Optionsschuldverschreibung zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der Optionsschuldverschreibung nicht überschreiten. Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach Maßgabe der vom Vorstand näher festzulegenden Anleihebedingungen in neue Aktien der ELMOS Semiconductor AG umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine neue Aktie der ELMOS Semiconductor AG. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung durch

den festgesetzten Wandlungspreis für eine neue Aktie der ELMOS Semiconductor AG ergeben. Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzenbeträge zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden.

Die Wandelanleihebedingungen können auch vorsehen, dass im Falle der Wandlung die Gesellschaft den Wandlungsberechtigten nicht Aktien der ELMOS Semiconductor AG gewährt, sondern den Gegenwert, der nach näherer Maßgabe der Wandelanleihebedingungen dem Durchschnittskurs der Aktie der ELMOS Semiconductor AG in der Xetra-Schlussauktion an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsentage vor dem Tag der Erklärung der Wandlung entspricht, ganz oder teilweise in Geld zahlt. Die Wandelanleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem vorhergehenden Zeitpunkt vorsehen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der bei der Wandlung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen nicht übersteigen. Der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis für eine neue Aktie der ELMOS Semiconductor AG muss – auch bei einem variablen Umtauschverhältnis/Wandlungspreis – entweder mindestens 80% des durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien der ELMOS Semiconductor AG in der Xetra-Schlussauktion an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsentage vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der Options- oder Wandelschuldverschreibungen betragen oder mindestens 80% des durchschnittlichen Börsenkurses in der Xetra-Schlussauktion an der Frankfurter Wertpapierbörse während der Tage, an denen die Bezugsrechte an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, jedoch mit Ausnahme der beiden letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels, entsprechen.

Der Options- bzw. Wandlungspreis wird unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen durch Zahlung eines entsprechenden Betrags in bar bei Ausnutzung des Wandlungsrechts bzw. durch Herabsetzung einer etwa vorgesehenen Zuzahlung ermäßigt, wenn die Gesellschaft während der Options- oder Wandlungsfrist unter Einräu-

mung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder weitere Options- und/oder Wandelanleihen begibt bzw. sonstige Options- und/oder Wandlungsrechte gewährt und den Inhabern schon bestehender Options- oder Wandlungsrechten kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrecht zustehen würde. Statt einer Zahlung in bar bzw. einer Herabsetzung der Zuzahlung kann auch – soweit möglich – das Umtauschverhältnis durch Division durch den ermäßigten Wandlungspreis angepasst werden. Die Bedingungen können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer außerordentlicher Maßnahmen eine Anpassung der Options- bzw. Wandlungsrechte vorsehen.

In den Options- und Wandelanleihebedingungen kann außerdem vorgesehen werden, dass die Zahl der bei Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte oder nach Erfüllung der Wandlungspflichten zu beziehenden Aktien bzw. ein diesbezügliches Umtauschrecht variabel sind und/oder der Options- bzw. Wandlungspreis innerhalb einer vom Vorstand festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses oder als Folge von Verwässerungsschutzbestimmungen während der Laufzeit verändert werden kann.

Die Options- oder Wandelschuldverschreibungen sollen von einer Bank oder einem Bankenkonsortium mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsrechtsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern von Options- oder Wandlungsrechten zu etwa bereits zuvor begebenen Wandelschuldverschreibungen bzw. den Inhabern von durch die Gesellschaft begebenen Optionsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte zustehen würde.

Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer einmaligen oder mehrfachen Ausgabe von Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen insoweit auszuschließen, als Options- bzw. Wandlungsrechte oder Wandlungspflichten auf

neue Aktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von bis zu maximal 10% des Grundkapitals der Gesellschaft gewährt werden, das beim erstmaligen Bezugsrechtsausschluss gemäß §186 Abs. 3 Satz 4 AktG – auch aufgrund anderer Ermächtigungen – vorhanden ist. Für die Frage des Ausnutzens der 10%-Grenze ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen in direkter oder entsprechender Anwendung des §186 Abs. 3 Satz 4 AktG mit zu berücksichtigen. Sofern der Vorstand von dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch macht, darf der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreiten.

Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats und gegebenenfalls im Einvernehmen mit den Organen der die Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen begebenden Beteiligungsgesellschaften die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Rückzahlungsbetrag, Laufzeit und Stückelung, Options- bzw. Wandlungspreis, Verwässerungsschutzbestimmungen, Options- bzw. Wandlungszeitraum sowie Umtauschmodalitäten bei Umtauschberechtigung zu bestimmen.

- b) Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 5 Mio. Euro durch Ausgabe von bis zu 5 Mio. neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Das bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Options- bzw. Wandlungsrechten – nach Maßgabe der Options- bzw. Wandlungsbedingungen – an die Inhaber von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die gemäß der unter vorstehend Buchstabe a) genannten Ermächtigung bis zum 09.05.2012 von der Gesellschaft oder durch unmittelbare oder mittelbare, inländische oder ausländische 100%ige Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaft begeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem gemäß Buchstabe a) jeweils festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, als (i) die Options- bzw. Wandelanleihen ausgeben werden und (ii) die Inhaber von ih-

ren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die aus der Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte oder Wandlungspflichten hervorgehenden neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.

- c) §3.6 der Satzung (Grundkapital) in der bisherigen Fassung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

„Das Grundkapital ist um maximal bis zu 5.000.000,- Euro (5 Mio. Euro) eingeteilt in bis zu 5.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus bis zum 09.05.2012 durch die Gesellschaft oder eine unmittelbare oder mittelbare inländische oder ausländische 100%ige Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft gemäß der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 10.05.2007 begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen Gebrauch machen oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren inländischen oder ausländischen 100%igen Beteiligungsgesellschaften bis zum 09.05.2012 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.“

- d) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von §3.1 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen nach

Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Wandel- oder Optionsrechten.

9 Beschlussfassung über die Änderung von §14 der Satzung (Bekanntmachungen)

Das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz, das am 20.1.2007 in Kraft getreten ist, stellt die Übermittlung von Informationen wie z.B. die Einladung zur Hauptversammlung an die Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung unter anderem unter den Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung, selbst wenn ein Aktionär in diese Form der Informationsübermittlung ausdrücklich eingewilligt hat. Um unseren Aktionären auch weiterhin Informationen elektronisch übermitteln zu können, soll die Satzung in §14 entsprechend ergänzt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

§14 der Satzung wird in der Überschrift geändert, der bisherige Satz 1 wird Absatz 1 und folgender zweiter Absatz wird angefügt:

„§14 Bekanntmachungen und Informationen

14.1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im elektronischen Bundesanzeiger, soweit nicht das Gesetz im Einzelfall zwingend etwas anderes bestimmt.

14.2 Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können auch mittels elektronischer Medien übermittelt werden.“

Berichte des Vorstands zur Hauptversammlung am 10. Mai 2007

Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung (Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien) gem. §71 Abs. 1 Nr. 8 i. V. m. §186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG

Die Gesellschaft hat in den vergangenen Hauptversammlungen zum Aktienrückkauf und zur anschließenden Veräußerung erworbener eigener Aktien ermächtigende Beschlüsse erfasst, deren letzter bis zum 18.11.2007 befristet ist. Wegen des Ablaufs der Ermächtigung im laufenden Geschäftsjahr soll mit dem vorliegenden Beschlussvorschlag die derzeit bestehende Ermächtigung ersetzt werden, die von der Hauptversammlung am 19.05.2006 beschlossen wurde.

Dabei soll die Gesellschaft neben dem Erwerb über die Börse, auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot (Tenderverfahren) zu erwerben. Bei dieser Variante kann jeder verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung im Verhältnis der angebotenen Aktien erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern.

Die ELMOS-Aktienoptionspläne 1999 und 2004 für Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der ELMOS Semiconductor AG sowie für Mitglieder der Geschäftsführungen und Mitarbeiter verbundener Unternehmen werden jeweils durch ein bedingtes Kapital abgesichert. Der unter Punkt 6. der Tagesordnung vorgeschlagene Beschluss soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, die Aktienoptionspläne 1999 und 2004 auch durch den vorherigen Erwerb eigener Aktien zu bedienen. Damit wird insbesondere eine Verwässerung der Altaktionäre durch die ansonsten erforderliche Kapitalerhöhung vermieden. Die Entscheidung darüber, wie die Optionen im Einzelfall erfüllt werden, treffen die zuständigen

Organe der Gesellschaft; sie werden sich dabei allein vom Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen und in der jeweils nächsten Hauptversammlung über ihre Entscheidung berichten.

Der Gesellschaft soll durch die eingeräumte Ermächtigung die Möglichkeit gegeben werden, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese gegen Sachleistung veräußern zu können, insbesondere als Gegenleistung bei Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Unternehmensbeteiligungen. Der nationale und internationale Wettbewerb sowie die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermächtigung bestehen nicht. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Er wird sich in der Regel, wenn er den Wert der als Gegenleistung hingebenen Aktien bemisst, am Börsenkurs der ELMOS Semiconductor AG-Aktie orientieren. Der Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils Bericht über eine Ausnutzung dieser Ermächtigung erstatten.

Darüber hinaus soll die Gesellschaft in der Lage sein, Aktien an Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführungen und Mitarbeiter von verbundenen Unternehmen, freie Mitarbeiter sowie Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft anzubieten und zu übertragen. Durch die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter des Unternehmens soll eine zusätzliche Form der aktienbasierten Vergütung geschaffen werden, um Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden bzw. qualifizierte neue Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen. Die Ziele der Motivation und Bindung der Mitarbeiter des Unternehmens liegen im Interesse der Gesellschaft. Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der Verwendung erworbener eigener Aktien ist hierfür Voraussetzung. Auch Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sollen die Möglichkeit erhalten, vom Aufsichtsrat Aktien als aktienbasierte Vergütung zugesagt oder übertragen zu bekommen. Die Möglichkeit, eigene Aktien als Vergütungsbestandteil auch an Vorstandsmitglieder zuzusagen oder übertragen zu können,

bindet die Mitglieder des Vorstands an das Unternehmen und dessen wirtschaftlichen Erfolg und liegt somit ebenfalls im Interesse der Gesellschaft. Die Mitglieder des Vorstands, die Aktien auf dieser Grundlage als Vergütung erhalten, haben ein zusätzliches Interesse daran, auf die Wertsteigerung der Gesellschaft, ausgedrückt im Börsenkurs, hinzuwirken. Sie tragen jedoch auch das Kursrisiko. Die Entscheidung hierüber obliegt allein dem Aufsichtsrat als zuständigem Entscheidungsorgan, das auch über die Modalitäten der aktienbasierten Vergütung an Vorstandsmitglieder unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zur Angemessenheit (§87 Abs. 1 AktG) befindet. Hierdurch ist sichergestellt, dass das Bezugsrecht der Aktionäre nicht übermäßig und nur im Interesse der Gesellschaft ausgeschlossen wird.

Die aufgrund des vorgeschlagenen Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien sollen von der Gesellschaft auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden können. Die Hauptversammlung kann gem. §237 Abs. 3 Nr. 3 AktG die Einziehung von Stückaktien beschließen, ohne dass damit eine Herabsetzung des Grundkapitals erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht diese Alternative neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung vor. Durch eine Einziehung eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die Anzahl der Stückaktien, die sich durch die Einziehung verringert, in der Satzung anzupassen.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 8 der Tagesordnung gemäß §221 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit §186 Absatz 3 Satz 4 und §186 Absatz 4 Satz 2 AktG

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu ermächtigen, bis zum 09.05.2012 einmalig oder mehrmals Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 5 Mio. mit einer Laufzeit von längstens zehn Jahren zu begeben und den Inhabern von Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte bzw. den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu Euro 5 Mio. zu gewähren.

Die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen soll im Interesse der Gesellschaft die Ausgabe möglichst günstiger, in besonderem Maße

den Anforderungen der Kapitalmärkte entsprechender Schuldverschreibungen ermöglichen. Gegebenenfalls sollen auch über unmittelbare oder mittelbare inländische oder ausländische 100%ige Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaft je nach Marktlage deutsche oder internationale Kapitalmärkte in Anspruch genommen werden können, und die Schuldverschreibungen sollen außer in Euro auch in der gesetzlichen Währung eines OECD-Staates ausgegeben werden können. Den Aktionären steht dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Es kann jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden. Die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses gibt der Gesellschaft die erforderliche Flexibilität, günstige Börsensituationen kurzfristig wahrzunehmen. Für den Bezugsrechtsausschluss gilt gemäß §221 Abs. 4 Satz 2 AktG die Bestimmung des §186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß, die vorsieht, dass ein Ausgabepreis festgelegt werden muss, der nicht wesentlich unter dem Börsenkurs liegt. Die Ermächtigung beinhaltet deshalb, dass der Ausgabepreis für die Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen den nach den anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Teilschuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreiten darf. Um dieser Anforderung auch bei der Begebung von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen zu genügen, wird der Vorstand bei jedem Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend §186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Gutachten einer anerkannten Investmentbank einholen. Damit wird dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen.

Damit die nach §186 Abs. 3 Satz 4 AktG einzuhaltende Begrenzung des Bezugsrechtsausschlusses auf insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschritten wird, ist weiter vorgesehen, dass von der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses nur insoweit Gebrauch gemacht werden darf, als beim erstmaligen Bezugsrechtsausschluss von etwaigen sonstigen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss gemäß §186 Abs. 3 Satz 4 AktG kein Gebrauch gemacht ist. Für die Frage des Ausnutzens der 10%-Grenze ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen in direkter oder entsprechender Anwendung des §186 Abs. 3 Satz 4 AktG mit zu berücksichtigen.

Im Übrigen ermöglicht es der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge, die Ermächtigung mit glatten Beträgen auszunutzen und dadurch die Abwicklung der Kapitalmaßnahme zu erleichtern. Der Ausschluss des Be-

zugsrechts zugunsten der Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen hat den Vorteil, dass im Falle einer Ausnutzung der Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis für die Inhaber bereits bestehender Optionsrechte, Wandlungsrechte bzw. von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen nicht nach den bestehenden Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigt zu werden braucht.

Das bedingte Kapital II (von 5.000.000,- Euro), wird benötigt, um Options- oder Wandelschuldverschreibungen mit Options- bzw. Wandlungsrecht oder -pflichten auf Aktien der ELMOS Semiconductor AG ausgeben zu können.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger 19.413.805,- Euro und ist eingeteilt in 19.413.805 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einer Stimme je Stückaktie. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte an der Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger beträgt damit jeweils 19.413.805.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach §11 der Satzung unserer Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden und einen von ihrem depotführenden Institut erstellen besonderen Nachweis ihres Aktienbesitzes an diese Adresse übermitteln:

ELMOS Semiconductor AG | c/o Deutsche Bank AG
General Meetings | 60272 Frankfurt am Main

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 19.04.2007 beziehen und der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 03.05.2007 unter der genannten Adresse zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und der Nachweis des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen.

Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären wie bisher an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Diesen Stimmrechtsvertretern müssen dazu eine Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Aktionäre, die von der Möglichkeit der Vollmachtserteilung Gebrauch machen wollen, benötigen dazu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt. Entsprechende Informationen sind auch im Internet unter www.elmos.de einsehbar.

Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Alle Aktionäre der ELMOS Semiconductor AG sowie die interessierte Öffentlichkeit können die Hauptversammlung auf Anordnung des Versammlungsleiters am 10.05.2007 ab 10.00 Uhr in voller Länge live im Internet verfolgen (www.elmos.de). Der uneingeschränkte Onlinezugang zur Live-Übertragung wird unter Investor Relations/Hauptversammlung ermöglicht.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Gegenanträge und Wahlvorschläge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten:

Hauptversammlungsstelle | ELMOS Semiconductor AG
Heinrich-Hertz-Straße 1 | 44227 Dortmund
Telefax: +49 (0) 231 -75 49 -548

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Bis spätestens zum Ablauf des 25.04.2007 unter vorstehender Adresse eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden nach Nachweis der Aktionärserschaft des Antragstellers den anderen Aktionären im Internet unter www.elmos.de unverzüglich zugänglich gemacht. Sofern sie auch in englischer Sprache veröffentlicht werden sollen, ist eine Übersetzung beizufügen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach dem 25.04.2007 ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Dortmund, im März 2007
Der Vorstand

Hinweise

Einlass

Der Einlass zur Hauptversammlung ist am 10.05.2007 ab 9.00 Uhr geöffnet.

Parkmöglichkeiten

Während der Hauptversammlung stehen für unsere Besucher Parkplätze am Casino Hohensyburg zur Verfügung. Wir bitten Sie, die Parkscheine bei der Anmeldung vorzulegen, damit wir sie gegen Parkgutscheine austauschen können, die es Ihnen ermöglichen, kostenlos zu parken.

Bus-Transfer vom/zum Busbahnhof Dortmund

Am Busbahnhof Dortmund – gegenüber des Hauptbahnhofes – steht um 9.00 Uhr ein kostenloser Bus-Transfer der Firma Horn-Reisen zu unserer Hauptversammlung im Casino Hohensyburg zur Verfügung. Dieser Bus fährt um 13.00 Uhr vom Casino Hohensyburg zurück zum Busbahnhof Dortmund.

Öffentliche Verkehrsmittel

Ab 14.03 Uhr fährt der Casinobus stündlich ab dem Casino Hohensyburg zum Busbahnhof nach Dortmund.

Wegbeschreibung

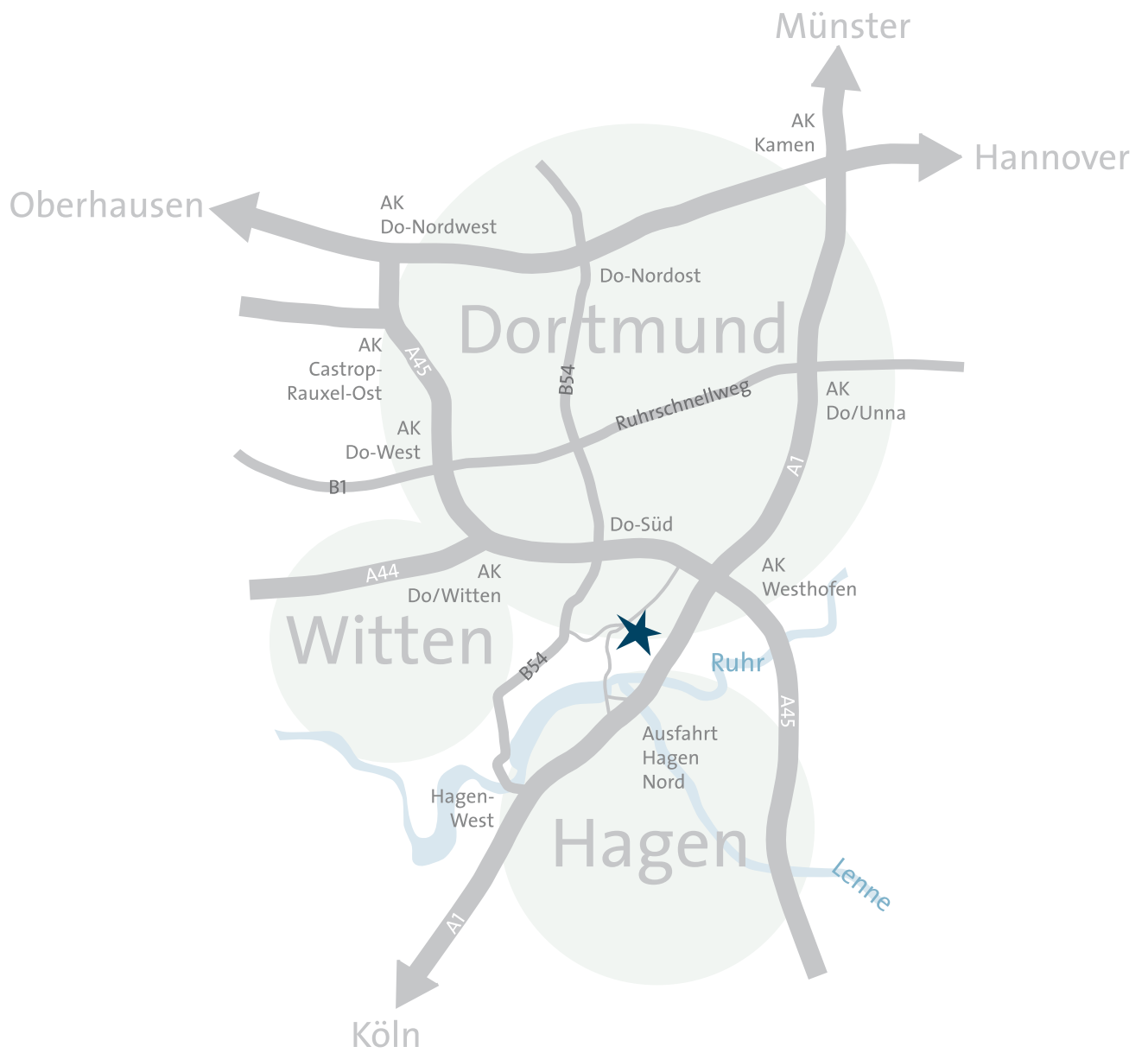
A1 aus Richtung Köln kommend Ausfahrt Hagen Nord. Von dort ist der Weg zum Casino Hohensyburg ausgeschildert.

Von der A44 oder A2 kommend zuerst Richtung Dortmund Zentrum. Von der Innenstadt über die B54 Richtung Süden zum Casino Hohensyburg.

Von der A45 kommend die Ausfahrt Dortmund Süd Richtung Hohensyburg nehmen. Ab der Ausfahrt ist das Casino Hohensyburg ausgeschildert.



Casino Hohensyburg
Hohensyburgstraße 200
44265 Dortmund



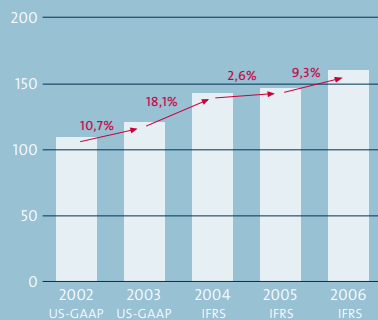
Fünfjahresübersicht ELMOS-Konzern

in Millionen Euro, soweit nicht anders angegeben	2002	2003	2004	2005	2006
	US-GAAP	US-GAAP	IFRS	IFRS	IFRS
Umsatz	109,7	121,4	143,3	147,0	160,7
Umsatzwachstum	2,5%	10,7%	18,1%	2,6%	9,3%
Bruttoergebnis	53,8	61,4	73,2	70,6	73,0
Bruttomarge	49,0%	50,6%	51,1%	48,1%	45,5%
Forschungs- & Entwicklungskosten	17,5	20,4	24,7	28,1	29,6
Forschungs- & Entwicklungskosten in % vom Umsatz	16,0%	16,8%	17,2%	19,1%	18,4%
EBIT	19,3	21,1	26,4	20,0	19,8
EBIT in % des Umsatzes	17,6%	17,4%	18,4%	13,6%	12,3%
Ergebnis vor Steuern	15,7	17,3	22,9	16,4	17,3
Ergebnis vor Steuern in % des Umsatzes	14,3%	14,2%	16,0%	11,2%	10,8%
Jahresüberschuss	8,9	10,0	14,2	10,0	10,7
Nettogewinnmarge	8,1%	8,3%	9,9%	6,8%	6,7%
Ergebnis je Aktie in Euro	0,46	0,52	0,74	0,52	0,55
Bilanzsumme	208,5	205,3	217,3	237,0	241,9
Eigenkapital	112,4	124,7	133,8	144,3	152,9
Eigenkapitalquote	53,9%	60,7%	61,6%	60,9%	63,2%
Finanzverbindlichkeiten	62,2	60,6	57,6	67,9	65,0
Zahlungsmittel und -äquivalente sowie Wertpapiere	11,1	25,9	18,9	16,8	16,6
Nettoverschuldung	51,2	34,7	38,7	51,2	48,4
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	26,0	6,5	34,7	19,7	28,5
Investitionen in das Anlagevermögen	- 34,1	- 25,3	- 33,5	- 29,6	- 26,4
Investitionen in % vom Umsatz	31,1%	20,9%	23,4%	20,1%	16,4%
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	- 29,3	3,4	- 31,2	- 30,4	- 19,9
Free Cash Flow*	- 3,3	10,0	3,5	- 10,7	8,6
Dividende je Aktie in Euro	0,00	0,13	0,21	0,00	0,00**
Mitarbeiter im Jahresmittel	830	874	928	1.028	1.102

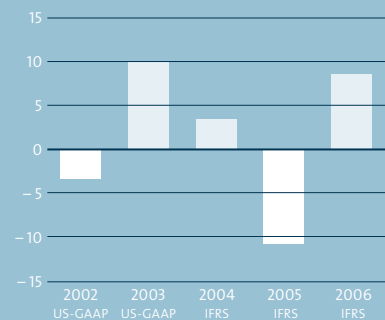
* Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit minus Cash Flow aus der Investitionstätigkeit

** Vorschlag für die Hauptversammlung im Mai 2007

Umsatz in Mio Euro
und Wachstum



Free Cash Flow
in Mio Euro





Sehr geehrte Aktionäre,

im abgelaufenen Jahr 2006 haben wir bedeutende Fortschritte im operativen Geschäft und in der strategischen Ausrichtung gemacht. Dies ist uns trotz einer schwierigen Ausgangslage gelungen. Um die im letzten Jahr formulierten Ziele zu erreichen, hat ELMOS an vielen Stellen im Unternehmen teils erhebliche Änderungen in Prozessen, Organisationen und der strategischen Ausrichtung vorgenommen. Damit haben wir dem weiteren profitablen Wachstum die Basis bereitet.

Kundenspezifische Halbleiterlösungen, so genannte ASICs, für den Einsatz in automobilen Applikationen sind zwar nach wie vor unser Kerngeschäft, wir haben aber begonnen, diese intakte Wachstumssäule durch den Aufbau weiterer Geschäftsfelder zu ergänzen. Diese nutzen unsere Kernkompetenzen und werden dazu beitragen, sie weiter auszubauen. Wir sind überzeugt davon, dass diese Felder mittelfristig entscheidende Wachstums- und Ergebnisbeiträge liefern werden. Insgesamt richten wir den Fokus unserer Arbeit auf weiteres ertragreiches Wachstum. Deswegen haben wir uns in unserem Geschäftsbericht diesem Thema gewidmet: weiter wachsen.

Unsere finanziellen Ziele für das vergangene Jahr waren angesichts der Ausgangslage ambitioniert. Die Herausforderung war, nach dem enttäuschenden Jahr 2005 mit einem Umsatzwachstum von nur 2,6 Prozent wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Damals hatten wir aus verschiedenen Gründen Aufträge verloren und umsatzstarke Projekte waren ausgelaufen. Vor diesem Hintergrund ist es erfreulich, dass wir unser Ziel von rund zehn Prozent Wachstum in 2006 erreichen konnten.

Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) in Höhe von 19,8 Millionen Euro wurde durch erhebliche Vorleistungen bei Mikrosystemprojekten und den Anlauf der 8-Zoll-Fertigung belastet, trotzdem haben wir das zuletzt avisierte EBIT-Ziel von 12 Prozent vom Umsatz erreicht. Das war möglich, weil das operative Kerngeschäft in seiner Ertragsstärke die Belastungen aus Vorleistungen zum großen Teil kompensierte. Der Jahresüberschuss 2006 beträgt 10,7 Millionen Euro oder 6,7 Prozent vom Umsatz und liegt damit auch im Rahmen unserer Prognose. Den freien Cash Flow konnten wir erfreulich positiv gestalten, mit 8,6 Millionen Euro haben wir auch hier die gesetzten Ziele erreicht.

Lassen Sie mich nun einige wichtige Punkte nennen, die das bisher Erreichte und unsere Zielsetzung für 2007 charakterisieren:

- ▶ Die neue 8-Zoll-Fertigung in Duisburg hat Mitte 2006 erste Produkte an Kunden geliefert. Zum Ende des Jahres 2006 haben wir bis zu 50 Wafer pro Tag in die Fertigungslinie eingesteuert. Auch 2007 werden wir die Fertigung weiterhin mit hohem Engagement erweitern. Auf der Kundenseite werden wir verstärkte Anstrengungen unternehmen, um ein schnelleres Einfließen unserer auf 8-Zoll-Wafern gefertigten Produkte in laufende Serien zu erreichen.
- ▶ Parallel zum Start der neuen Fertigung in Duisburg haben wir den neuen Testbereich in Dortmund plangemäß in Betrieb genommen. Hier haben wir die Kapazitäten geschaffen, die für unser Wachstum nötig sind.
- ▶ Wir haben mit der Gründung der Tochtergesellschaft ELMOS Industries das Fundament für ein Wachstum in den Märkten der Industrie- und Konsumelektronik gelegt. Der Umsatzanteil dieser Märkte von derzeit rund zehn Prozent am Gesamtumsatz soll mittelfristig 20 bis 30 Prozent betragen.
- ▶ Wir haben den Startschuss für sechs applikationsspezifische Standardprodukt-Familien (ASSPs) gegeben. Durch den vermehrten Direktvertrieb solcher Produktreihen und der Unterstützung durch ELMOS Industries können wir die Partnerschaft mit schon vorhandenen Kunden auf weiteren Feldern ausbauen. 2007 werden erste Projekte in Serie gehen.

- ▶ Unsere Mikrosystemprojekte wecken durchweg großes Interesse bei den Kunden. Wir werden 2007 beweisen, dass unsere Pionierarbeit auf diesem Feld den Kunden große Vorteile bei ihren Applikationen bringt. Der erfolgreiche Start weiterer Projekte ist ein wichtiges Thema 2007.
- ▶ Die erweiterte Kooperation mit Freescale Semiconductor für System-in-Package-Solutions eröffnet neue Perspektiven. Die aus dieser Kooperation entstehenden Multi-Chip-Produkte kombinieren die leistungsfähigen 16-Bit Mikrocontroller-Architekturen (MCU) von Freescale mit den applikationsspezifischen Hochvolt-CMOS Chips von ELMOS. Dies hilft uns bei der Entwicklung und Herstellung intelligenter Lösungen für die Komfort- und Karosserieelektronik im Automobil. 2007 werden erste Produkte vorgestellt.
- ▶ Für unsere Vertriebsaktivitäten in Fernost haben wir einen kompetenten Partner in Südkorea gewonnen. Gemeinsam werden wir unsere Produkte in diesem Markt stärker forcieren.
- ▶ Mitte 2006 haben wir mit der Verlagerung des Standardgehäuse-Assembly von unserer Tochtergesellschaft in den Niederlanden zu externen Dienstleistern in Asien begonnen, um so Kostenvorteile zu nutzen. Mehr als 40 Prozent der in 2006 bei ELMOS Advanced Packaging erreichten Wertschöpfung war bereits höherwertigen Spezialgehäusen zuzurechnen. Nach Abschluss der Verlagerung der Standardgehäuse im Jahr 2007 wird sich unsere Tochtergesellschaft komplett auf die Entwicklung und Fertigung von Spezialgehäusen konzentrieren.
- ▶ Erste Pilotdesigns in hochintegrierten Logikprozessen mit Foundrypartnern wurden realisiert, um uns so Zugang zu modernsten Technologien zu sichern, ohne eigene, hohe Investitionen in Fertigungseinrichtungen tätigen zu müssen.
- ▶ Mit unserer nachhaltigen Initiative zur Qualitätsverbesserung unserer Produkte haben wir Erfolg und erfahren positive Rückmeldung seitens unserer Kunden.

Sie sehen, wir haben das vergangene Jahr aktiv genutzt, um unsere Strategie in wesentlichen Punkten weiter zu entwickeln, Verbesserungen im operativen Bereich zu erzielen und die Weichen auf Wachstum zu stellen. Diese Aktivitäten werden mit unverminderter Energie 2007 fortgeführt.

Auch personell haben wir uns weiter verstärkt. Nicolaus Graf von Luckner verantwortet seit dem 1. Juli 2006 das Finanzressort. Damit wird der Bereich Finanzen im Vorstand – nach dem Tod des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Knut Hinrichs – wieder durch einen Kaufmann vertreten. Insgesamt verfügt Graf von Luckner über 27 Jahre Berufserfahrung im Automobilbereich. Seine Kompetenz ist eine wertvolle Bereicherung für uns.

Dr. Klaus Weyer hat zum 31. Dezember 2006 den Vorstand verlassen. Dennoch bleibt er als Mitgründer des Unternehmens und Pionier im Bereich der Automobilelektronik mit seinem Know-how als Aufsichtsratsmitglied der ELMOS weiter erhalten. Im Namen des gesamten Vorstandes danke ich Dr. Klaus Weyer ausdrücklich für seine herausragenden Leistungen.

Erwähnen wollen wir auch, dass das Jahr 2006 durch Umstände geprägt war, die uns vor zusätzliche Herausforderungen gestellt haben. Aufgrund der Schwäche der amerikanischen Automobilhersteller ist unser USA-Geschäft rund zehn Prozent unter unseren Erwartungen geblieben. Die Energie- und Rohstoffpreise, insbesondere bei unserem Ausgangsmaterial, den Silizium-Wafern, sind deutlich gestiegen. Diese Belastungen werden im Jahr 2007 anhalten.

Die Marktbedingungen bezüglich unserer Automobilkunden haben sich schneller als jemals zuvor geändert. So fordern unsere Kunden wesentlich mehr Unterstützung bei der Integration unserer Chips in ihre Applikationen. Das bedeutet einerseits Mehraufwand, andererseits aber eine Chance zur Marktdifferenzierung. Das gilt vor allem dann, wenn wir patentierte Technologien in unseren Produkten, wie z.B. das neue Konzept zur Ansteuerung von Bürstenlosen-Motoren, namens VirtuHall®, einsetzen.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass wir das Jahr 2007 nutzen werden, um unsere Strategie weiter konsequent umzusetzen. Die strategischen Ziele werden durch operative Schwerpunktthemen, die unsere Wettbewerbsfähigkeit unterstützen, begleitet. Beispielsweise werden die Programme für erfolgsbezogene Entlohnung in den Bereichen Produktion, Entwicklung und Vertrieb für eine weitere Effizienzverbesserung in den Abläufen sorgen. Von der Einführung einer verbesserten Balanced Scorecard in der Fertigung versprechen wir uns ebenso weitere Kosteneinsparungen. Die Verlagerung der Standardgehäuse nach Fernost wird ebenfalls positive Beiträge zur Ergebnissituation liefern.

Vor dem Hintergrund der geschilderten Anstrengungen, dem Marktumfeld und den erheblichen Vorleistungen erwarten wir 2007 ein solides Umsatzwachstum von rund zehn Prozent und eine im Vergleich zum Vorjahr stabile Bruttomarge von rund 45 Prozent.

Sie sehen, ELMOS unternimmt große Anstrengungen, um nicht nur in 2007 weiter zu wachsen, sondern die Voraussetzungen für weiteres Wachstum und Profitabilität in den kommenden Jahren zu schaffen. Das bisher Erreichte stimmt uns zuversichtlich, dass wir weitere Verbesserungen erzielen werden. Nicht zuletzt sind es auch die Rückmeldungen unserer Kunden, die mich positiv stimmen. In zahlreichen persönlichen Gesprächen haben sie unsere Leistungen anerkannt und uns mit ehrgeizigen Aufgabenstellungen zu weiteren Höchstleistungen angespornt.

Lassen Sie mich an dieser Stelle den drei wichtigsten Eckpfeilern unseres Geschäftes einen besonderen Dank, auch im Namen des ganzen Vorstandes, aussprechen: unseren Kunden, weil wir ohne sie nicht gebraucht werden, unseren Mitarbeitern, weil wir von ihnen und ihren Leistungen als Firma getragen werden, und nicht zuletzt gilt unser Dank Ihnen, unseren Aktionären, die Vertrauen in unser Unternehmen haben.

Vor uns liegt ein Jahr der Weiterentwicklung und des weiteren Wachstums.

Ihr


Dr. Anton Mindl

Vorstandsvorsitzender der ELMOS Semiconductor AG

Geschäft und Rahmenbedingungen

Geschäftstätigkeit

ELMOS entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte, zumeist anwendungsspezifische, mikroelektronische Schaltkreise, vornehmlich für die Automobilindustrie. Auch im Jahr 2006 entfielen rund 90 Prozent vom Umsatz auf dieses Marktsegment. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat ELMOS sich eine führende Marktposition als Halbleiterhersteller im europäischen Markt für Automobilelektronik erarbeitet. Unverändert wird ELMOS, wie auch in den vergangenen Jahren, mit 12 Prozent Marktanteil von dem Marktforschungsinstitut Gartner Dataquest im März 2006 als die weltweite Nummer drei im Segment der ASICs (Application Specific Integrated Circuits) für den Automobilmarkt nach den Firmen STMicroelectronics und NEC aufgeführt. Die direkten Wettbewerber AMI Semiconductor und Melexis folgen auf den Plätzen vier und fünf.

ELMOS-Chips werden von nahezu allen europäischen Fahrzeugherstellern eingesetzt. Stetig wachsende Anforderungen an die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und die Umweltverträglichkeit eines Kraftfahrzeugs sowie an Sicherheit und Komfort führen zu immer mehr Elektronik im Auto. Halbleiterbausteine von ELMOS sind ideal geeignet, solche Systeme kompakt, zuverlässig und kostengünstig aufzubauen.

Automobile Neuprojekte benötigen in der Regel drei bis vier Jahre Entwicklungszeit, bevor sie für etwa fünf Jahre in Serie produziert werden. Teilweise verlängert sich diese Produktionszeit erheblich, wenn Autohersteller eine ähnliche technische Plattform in einer Familie von neuen Modellen einsetzen. Zum Zeitpunkt des Gewinns eines Neuprojekts werden in der Regel die Preise in Abhängigkeit von geplanten Mengen für die gesamte Projektlaufzeit kalkuliert.

Seit mehr als 20 Jahren bedient ELMOS Nischenmärkte mit eigenem Know-how. Es ist die Strategie, zum einen durch eine konsequent an den Marktbedürfnissen ausgerichteten Fertigungstechnologie und zum anderen durch die kundenspezifische Produktentwicklung zu überzeugen. So entwickelt ELMOS in der Regel Produkte im Kundenauftrag für eine spezielle Anwendung und produziert diese exklusiv für diesen Kunden. ELMOS ist bestrebt, als kompetenter Partner der Kunden mit maßgeschneiderten, integrierten Schaltungen ein profitables Geschäft zu betreiben und die eigenen Marktanteile zu erhöhen.

Neben den kundenspezifischen Schaltkreisen, die etwa 90 Prozent der Produkte umfassen, verfügt ELMOS zudem über ein Portfolio von anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs) sowie von mikromechanischen Sensoren aus der Produktion der Tochtergesellschaft Silicon Microstructures Inc. (SMI) in Milpitas, Kalifornien/USA. SMI entwickelt, produziert und vertreibt mikromechanische Bauelemente (MEMS) und zählt zu den Technologieführern im Bereich der hochpräzisen Drucksensoren in Silizium. Neben Drucksensoren entwickelt SMI Sensoren für Beschleunigung und Drehbewegungen, die speziell für die Automobilindustrie geeignet sind. Mit

einer eigenen Fertigung in Kalifornien verfügt SMI über stabile Serienfertigungseinrichtungen und -fähigkeiten. Darüber hinaus unterstützt die produzierende Tochterfirma ELMOS Advanced Packaging B.V. (ELMOS AP) mit Sitz in Nijmegen, Niederlande, das Technologie- und Produktportfolio. ELMOS AP entwickelt und fertigt Gehäuse für elektronische Halbleiterkomponenten und Sensoren. Neben Standardgehäusen gemäß JEDEC-Normen gehören vor allem kunden- und applikationsspezifische Spezialgehäuse, die sich teilweise durch patentiertes Know-how vom Wettbewerb unterscheiden, zum Produktportfolio. Die Fabrik in Nijmegen entspricht dem modernsten Stand der Technik. ELMOS AP deckte in 2006 noch rund 40 Prozent des Assembly-Bedarfs für ELMOS ab. Neben der konzerninternen Assemblierung fertigt die Gesellschaft auch Sondergehäuse für Drittkunden. In Zukunft wird sich ELMOS AP komplett auf die Entwicklung und Herstellung von Spezialgehäusen fokussieren. Die Produktion von Standardgehäusen wird zu langjährigen Partnern nach Südostasien verlagert.

Eigene
Fertigungsstätten

ELMOS produziert alle ASICs in einer eigenen Produktionsstätte für Halbleiterbauelemente (Wafer-Fab) in Dortmund sowie in der im Berichtsjahr in Betrieb genommenen Produktionslinie in Duisburg. Sowohl durch die automobilgerechte Hochvolt-CMOS Technologie als auch durch die systemgerechte Integration von analogen und digitalen Funktionen mit On-Chip Treiberleistungen unterscheidet sich ELMOS von den meisten Wettbewerbern.

Der in 2005 neu geschaffene Bereich ELMOS Microsystems ergänzt dieses Angebot durch die Entwicklung und Vermarktung von anwendungsspezifischen, mikro-mechatronischen Modulen. Diese Module kombinieren die Fähigkeiten der drei entwickelnden und produzierenden Unternehmen der ELMOS-Gruppe und bestehen aus signalverarbeitenden Halbleiterbauelementen, mikromechanischen Sensoren und funktionalem Gehäuse. Damit kann der Kunde kostengünstige Systemlösungen realisieren.

Neben dem automobilen Markt ist ELMOS außerdem im Industrie- und Konsumbereich tätig und liefert kundenspezifische Schaltkreise z.B. für Anwendungen in Haushaltsgeräten, Fotoapparaten, Installations- und Gebäudetechnik und Maschinensteuerungen. Diese nicht automobilen Märkte werden in Zukunft von der im Berichtsjahr gegründeten ELMOS Industries intensiv betreut. Sie haben im vergangenen Jahr, wie in den Vorjahren, rund zehn Prozent des Umsatzes ausgemacht.

Strategie

ELMOS ist mit einer klaren Strategie in das Berichtsjahr gestartet und hat dabei deutliche Fortschritte gemacht. Im Vordergrund stand die Fokussierung auf kundenspezifische, automobiler Applikationen, bei denen ELMOS jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der automobilen Halbleiter hat. Hier war die Inbetriebnahme der zweiten Produktionsstätte in Duisburg sowohl für die Versorgungssicherheit als auch für die Nutzung der Kostensenkungspotenziale aufgrund des größeren Waferdurchmessers ein wichtiger Schritt. Erste Kundenfreigaben wurden im dritten Quartal erteilt, weitere folgten zum Jahresende.

Fokussierung auf
kundenspezifische, automobiler
Applikationen

Daneben stand der Ausbau der Entwicklung und des Vertriebs von Applikations-Standards (ASSPs) im Fokus. Hierfür hat ELMOS den Bereich Applikationen & Systeme (AS) geschaffen,

der gezielt Applikations-Standards produziert und vertreibt. Hierbei fließen insbesondere auch patentrechtlich geschützte Verfahren wie HALIOS® und VirtuHall® ein, die für ELMOS Wettbewerbsvorteile bringen. Eine derartige Familie von Applikations-Standards erlaubt dem Anwender die schnelle und einfache Realisierung von intelligenten Lösungen z.B. für Sensor- bzw. Antriebsanwendungen.

Mikrosysteme wecken
großes Marktinteresse

Mikrosysteme, bestehend aus ASICs und MEMS in einem kundenspezifischen Package, stoßen derzeit auf großes Interesse im Markt. Mit der Fähigkeit, solche Systeme im internen Firmenverbund zu entwickeln und zu produzieren, grenzt sich ELMOS klar von seinen Wettbewerbern ab und offeriert ihren Kunden einen einzigartigen Vorteil.

Fortschritte wurden auch bei der Integration von Fremdsilizium in eigene Systemlösungen erzielt. Erste Projekte, basierend auf nicht selbst produzierten Bauelementen, wurden bis zur Prototypenreife vorgebracht. Diese Zukaufelemente werden entweder bei strategischen Partnerfirmen oder bei großen Halbleiterfoundries in von ELMOS nicht angebotenen Technologien nach Konstruktionsplänen von ELMOS produziert. Dank der technischen Möglichkeiten von ELMOS AP werden eigene und fremdbezogene Bauelemente in funktionalen Gehäusen als Multi-Chip-Modul zusammengefasst.

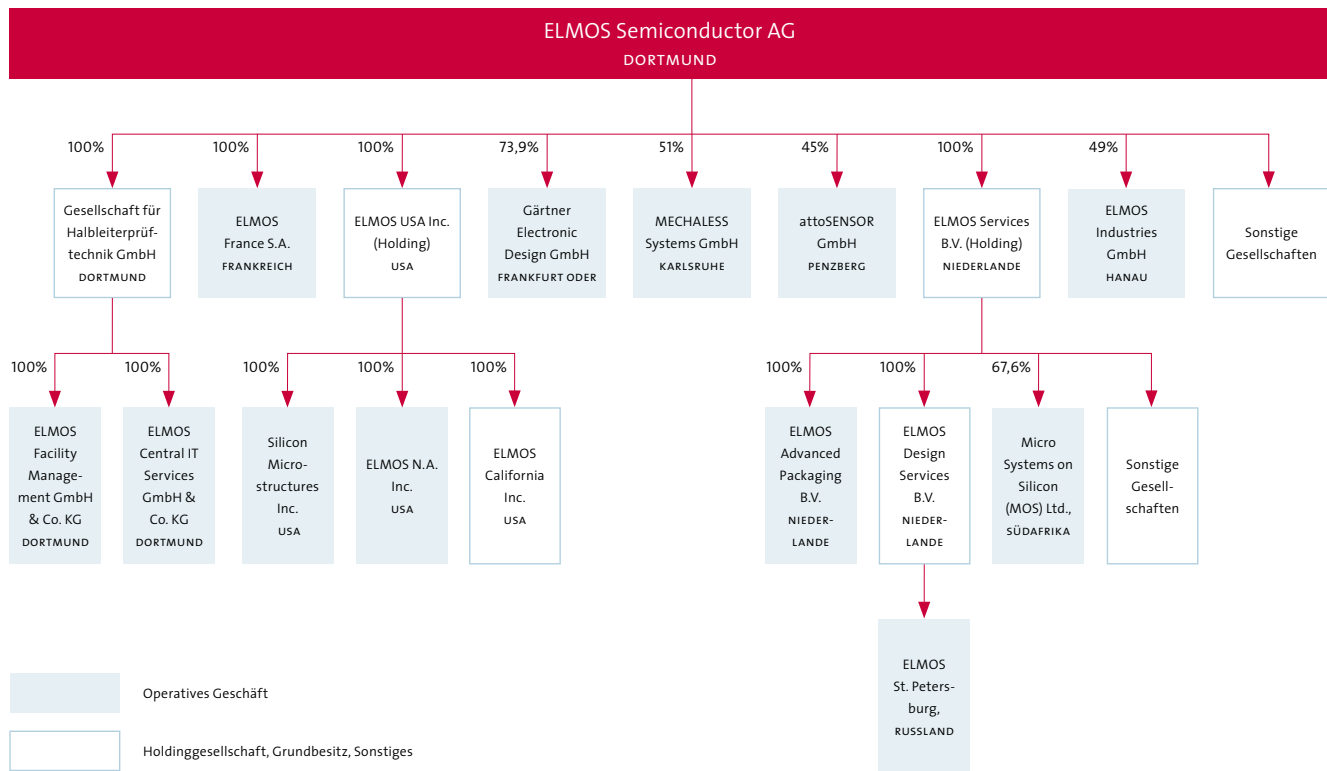
Schließlich wurde die geplante Adressierung zusätzlicher Märkte neben dem Automobilmarkt durch die Gründung der ELMOS Industries umgesetzt. Diese Tochterfirma hat im vierten Quartal des Berichtsjahres ihre Arbeit aufgenommen. Für nicht-automobile Märkte, d.h. Industrie- und Konsummärkte, strebt ELMOS mittelfristig einen Umsatzanteil von 20 bis 30 Prozent des Gesamtumsatzes an.

Organisationsstruktur

Orientierung an der
Automobilindustrie

Das ELMOS-Geschäftsmodell orientiert sich an den Anforderungen der Automobilindustrie sowie an den Bedürfnissen der Kunden nach Innovation, Qualität, Flexibilität und Liefertreue. Die daraus resultierende enge Kunden-Lieferantenbeziehung spiegelt sich in der verteilten Struktur der ELMOS-Gruppe wider. Diverse Niederlassungen, Tochter- und Partnerfirmen an mehreren Standorten in Deutschland, Europa und weltweit dienen der Vertriebs- und Applikationsunterstützung beim Kunden vor Ort. Dies umfasst unter anderem die Niederlassungen in München und Stuttgart, die Tochtergesellschaften ELMOS France, ELMOS North America, MECHALESS und GED sowie die Kooperationspartner attoSENSOR, DMOS und MAZ. ELMOS France betreut Frankreich und Südeuropa und bietet Applikationsunterstützung und Customer Service vor Ort. Der französische Markt ist aktuell für ELMOS neben Deutschland die wichtigste Region. ELMOS North America bedient den nordamerikanischen Markt von ihrem Sitz in Farmington Hills bei Detroit/USA aus, dem Zentrum der amerikanischen Automobilindustrie. Neben der Vertretung in Tokio ist im Berichtsjahr ein zweiter asiatischer Stützpunkt in Seoul, Korea, hinzugekommen.

Organisationsstruktur im Überblick



In der Segmentberichterstattung unterscheidet EL MOS zwischen den Bereichen Halbleiter und Mikromechanik. Das Segment Mikromechanik reflektiert die Geschäftstätigkeit von SMI. Die weiteren Gesellschaften und Aktivitäten werden im Segment Halbleiter geführt.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die EL MOS Finanzholding GmbH (EFH) ist mit einem mittelbaren und unmittelbaren Anteilsbesitz von 52,9 Prozent größter Einzelaktionär der EL MOS Semiconductor AG. Daher hat der Vorstand gemäß §312 AktG einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt, der mit folgender Erklärung gemäß §312 Abs. 3 AktG abschließt:

„Wir erklären, dass unsere Gesellschaft nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen und die Maßnahmen getroffen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Nachteile im Sinne von §312 AktG haben sich aus den Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für uns nicht ergeben.“

Rahmenbedingungen

Automobiler Halbleitermarkt

Der für EL MOS relevante Markt ist der der Halbleiterchips für die Automobilindustrie. Dieser Markt stellt einen Nischenmarkt der globalen Halbleiterindustrie dar. Er umfasst weltweit einen Anteil von rund sieben Prozent des gesamten Halbleitermarkts. Bedingt durch den Einfluss der relativ konstanten Automobilproduktion und des zunehmenden Anteils der Elektronik im Fahrzeug weist der automobiler Halbleitermarkt eine deutlich höhere Stabilität auf als der globale Halbleitermarkt, welcher hauptsächlich durch die Entwicklungen bei Speicher- und Kommunikationschips geprägt ist. Es wird erwartet, dass der Wertanteil der Elektroniksysteme bei höherwertigen Fahrzeugen von heute rund 25 Prozent bis 2010 auf rund 35 Prozent ansteigen wird. Elektronik und Mikroelektronik für den Automobilerinsatz wuchsen in der Vergangenheit und wachsen auch langfristig um ein Vielfaches schneller als die Zahl der neu produzierten Kraftfahrzeuge. Eine Fortsetzung dieses Trends ist mindestens für die nächsten zehn Jahre zu erwarten.

Langfristige Kundenbeziehungen

Spezielle Differenzierungsmerkmale des automobilen Halbleitermarkts sind die für die Halbleiterbranche untypisch lange Produktlebensdauer und die dadurch bedingten langen Lieferzeiträume von teilweise mehr als zehn Jahren. Zudem unterscheidet sich der Markt durch langfristige Kunden-Lieferanten-Beziehungen und die sehr hohen Qualitätsanforderungen sowie besonders harte Umgebungsbedingungen, die robuste Halbleitertechnologien erfordern.

Der weltweite Markt der automobilen Halbleiter betrug im Jahr 2006 19,1 Milliarden US-Dollar. Für die kommenden Jahre sagen Experten ein Wachstum für den automobilen Halbleitermarkt von sieben bis acht Prozent pro Jahr voraus. So erwartet das Marktforschungsinstitut Semicast Estimates, dass der Markt bis 2015 auf 36,5 Milliarden US-Dollar anwachsen wird.

ASIC-Markt im Fokus

Der von EL MOS maßgeblich adressierte Markt ist wiederum nur ein Teil des automobilen Halbleitermarkts, nämlich der der vorwiegend kundenspezifischen Halbleiter, der sogenannten ASICs. Wegen der vergleichsweise geringen Jahresstückzahlen stehen diese ASICs nicht im Fokus der großen Halbleiterhersteller, welche eine hohe Auslastung für ihre großen Produktionskapazitäten benötigen. Weitere Differenzierungsmerkmale des ASIC-Geschäftes sind sehr enge Lieferbeziehungen des Kunden zu einem einzelnen ASIC-Hersteller, die unter anderem aus dem Wunsch des Kunden nach Schutz des eigenen Know-hows entstehen. Wettbewerber der EL MOS sind bei typischen ASIC-Projekten mit mittleren Stückzahlen Firmen ähnlicher Größe wie AMI Semiconductor, Melexis, austria micro systems und Micronas. Bei sehr großen Stückzahlen steht EL MOS auch in Konkurrenz zu Großproduzenten wie Infineon, STMicroelectronics und Freescale.

Wirtschaftliches Umfeld

Im Jahr 2006 hat sich der Trend des Jahres 2005 fortgesetzt. Die Konsolidierung im Automobilmarkt hält unvermindert an, die Anzahl der Zulieferer sinkt. Die durchschnittlichen Volumina der Projekte steigen an und damit auch der Preisdruck. Dieser wird von den Automobilherstellern in Form von Kostensenkungsprogrammen an die sogenannten „Tier 1“ Hersteller, die Zulieferer der ersten Reihe, weitergegeben. Diese reichen den Preisdruck bei der Verhandlung von Neuprojekten an ihre Zulieferer weiter.

Da die Produktentwicklungszeiten in der Automobilindustrie immer kürzer werden, steigt auch der Termindruck an. Durch eine nach langfristigen Verhandlungen verspätete Auftragsvergabe wird die Situation häufig noch verschärft. Andererseits können selbst kleinste Überschreitungen des Projektendtermins dazu führen, dass ein Auftrag nicht in die Produktion überführt werden kann.

Auch bei der Übernahme der Entwicklungskosten gelten härtere Spielregeln. Früher hat der Kunde in der Regel rund die Hälfte der Entwicklungskosten übernommen. Heute ist die Bereitschaft zur Übernahme von Entwicklungskosten durch den Kunden stark rückläufig, was sich durch den härteren Wettbewerb erklären lässt. Damit wächst die Gefahr, dass der Kunde ein Projekt abbricht, z.B. weil er den Auftrag von seinem Endkunden verloren hat.

Besonders bei sehr großen Projekten verlangt der Kunde in der Regel die Umlage der Entwicklungskosten in die Serie. Zudem sind hier häufiger parallele Entwicklungen durch zwei Lieferanten – im Gegensatz zum früher üblichen Single-Sourcing – anzutreffen. Eine Folge davon und des starken Kostendrucks ist, dass heutzutage ein Wechsel des Zulieferers bei derartigen Projekten sogar während der Serienproduktion eines Fahrzeugs möglich ist.

Geschäftsverlauf im Jahr 2006

Das Jahr 2006 verlief für ELMOS insgesamt zufriedenstellend. Nach dem deutlichen Einbruch im dritten Quartal 2005 konnte seither Quartal für Quartal ein Umsatzwachstum sowie eine Verbesserung der wesentlichen Kennzahlen erzielt werden. Insgesamt wurde im Berichtsjahr ein Umsatz von mehr als 160 Millionen Euro erreicht, dies entspricht einem Wachstum zwischen neun und zehn Prozent ausgehend von 147 Millionen Euro Vorjahresumsatz. Dies ist umso bemerkenswerter, da der amerikanische Automobilmarkt eine ausgeprägte Schwäche zeigte und unsere Umsatzerwartungen dort um mehr als zehn Prozent verfehlt wurden.

Die negativen Einflussfaktoren des Vorjahres wie Preisdruck, veränderter Produktmix sowie Verschiebungen und Stornierungen von Projekten wirkten auch im Berichtsjahr fort. Daneben mussten die deutlich gestiegenen Rohstoffkosten – vor allem für Siliziumwafer, aber auch für Edelmetalle – und die höheren Energiekosten aufgefangen werden. Schließlich belasteten die Aufwendungen für den Anlauf der zweiten Fertigungslinie in Duisburg sowie Vorleistungen für Mikrosysteme und ASSPs die Bruttomarge, die bei einer Marke von 45% im Jahresverlauf verharrte.

Produktion

Komplexität der Produkte gestiegen

In 2006 wurden 15 Prozent mehr Chips produziert als im Jahr zuvor. Dabei sind die Anforderungen an die Produkte und damit deren Komplexität, gemessen an der Anzahl der zu strukturierenden Ebenen (Layer) erheblich gestiegen.

Die 2006 an Kunden ausgelieferten ASICs und ASSPs wurden überwiegend am Hauptstandort Dortmund auf der 150 mm-Wafer-Linie (entspricht 6 Zoll) produziert. Die Produktion auf der 200 mm-Wafer-Linie (entspricht 8-Zoll) am Standort Duisburg wurde in der zweiten Jahreshälfte für ausgewählte automotiv ASICs lieferwirksam.

Die Linie in Dortmund wurde im Berichtsjahr weiter planmäßig ausgebaut, um für die nächsten Technologie-Generationen und den steigenden Kapazitätsbedarf der Produktion vorbereitet zu sein.

Zum Jahresende 2006 lag die Maschinenkapazität bei rund 480 Waferstarts pro Tag; die durchschnittliche Ausnutzung übertraf mit 430 Waferstarts pro Tag das Niveau des Vorjahres (rund 400 Waferstarts). Insgesamt wurden in 2006 über 177.000 Wafer (2005: ca. 131.000 Wafer) gefertigt.

Vierter Bauabschnitt fertiggestellt

Die Kapazität der bestehenden Produktionslinie in Dortmund kann nach wie vor durch Rekrutierung weiterer Mitarbeiter und durch weitere Investitionen in Maschinen und den Ausbau von Räumen erweitert werden. Im Jahr 2006 wurde der vierte Bauabschnitt fertiggestellt, der neue Reinraumflächen für die Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2006 verfügbar machte. Dieser Baukörper wird seit dem dritten Quartal 2006 für eine Erweiterung unseres Testbereiches genutzt und kann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt auch Raum für die Erweiterung des Frontends schaffen.

Der zweite Baustein zur Kapazitätssicherung ist die Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS) in Duisburg. ELMOS hat in 2006 den Transfer erster Prozesstechnologien und die Qualifikation der dort existierenden 200mm-Wafer-Linie abgeschlossen sowie die Freigabe erster Produkte erreicht. Wie geplant konnten ab Mitte 2006 die Produktionslose in Duisburg gestartet und geliefert werden.

Der behutsame Ausbau der Kapazitäten in Dortmund, die neue Produktionsstätte in Duisburg sowie die zukünftige Nutzung von Foundry-Kapazitäten stellen die erforderliche Fertigungskapazität für die mittelfristige Zukunft der ELMOS sicher.

Verlagerung des Standardprodukte-Assemblys

Im Geschäftsbereich Assembly (ELMOS AP) wurde im Geschäftsjahr 2006 mit der Verlagerung von Standardprodukten zu Assemblypartnern im asiatischen Raum begonnen. Damit wurden interne Kapazitäten für höherwertige Spezialprodukte geschaffen und die Kostenvorteile aus dem Euro-Dollar-Wechselkurs erschlossen. Im Laufe des Jahres 2007 soll die Verlagerung der Standardgehäuse abgeschlossen werden.

Forschung und Entwicklung

Die hohen Anforderungen der Automobilindustrie an Qualität und Zuverlässigkeit führen zu verlangsamter Einführung neuer Technologiegenerationen bei Halbleitern in der Automobil-elektronik. Allerdings nutzen Industrie- und Konsumgütermärkte neue Technologien als Innovationstreiber. ELMOS nutzt diesen Sachverhalt indem z.B. in Konsumgütermärkten gereifte Innovationen später im Automobil eingeführt werden. Dies führt zu besserer Qualität auch bei neuen Produkten für das Automobil.

Im Berichtsjahr war ein klarer Schwerpunkt der Aktivitäten in Forschung und Entwicklung der Abschluss des Transfers des 0,8µm-Prozesses zum Standort Duisburg. Die ersten Kundenfreigaben wurden planmäßig im Sommer erteilt. Im weiteren Verlauf des Jahres startete der Serienanlauf mit transferierten Produkten. Die Arbeiten zur Entwicklung neuer Prozesstechnologien mit kleineren Strukturgrößen (0,35µm-Technologie) und Flash-Option machten einen weiteren Teil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung aus. Diese Aktivitäten wurden parallel dazu in Duisburg direkt in der 200mm-Linie durchgeführt, um mit den hochintegrierenden Technologien und den großen (200mm) Wafern den größten Kostenvorteil zu erreichen. Damit verfolgt ELMOS weiterhin die Strategie, durch eigene Prozesstechnologien innovative und wettbewerbsüberlegene Lösungen anbieten zu können.

Neben den Entwicklungen neuer Prozesse entfällt der mit Abstand größere Teil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf die Entwicklung neuer Produkte. Wie schon in der Vergangenheit, verstärkte sich im Jahr 2006 die Tendenz, dass der Kunde die Kosten für Forschung und Entwicklung eines ASICs nicht mehr übernimmt. Dies bedeutet, dass ein Großteil der Produktentwicklungskosten vom ASIC-Lieferanten, das heißt ELMOS, vorfinanziert werden muss und sich erst über die Serienfertigung amortisieren kann. Dies trifft natürlich in besonderem Maße für die Entwicklung von ASSP-Familien zu. In Folge davon stiegen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Millionen Euro auf 29,6 Millionen Euro an, entsprechend einer Quote von rund 18,4 Prozent vom Gesamtumsatz.

Mitarbeiter

Als Technologieunternehmen profitiert ELMOS in besonderem Maße vom Know-how der Mitarbeiter. Deren Motivation, Wissen und Flexibilität sind die Voraussetzung für den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Besonders in der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren sind die Mitarbeiter das entscheidende Kriterium für das Wachstum und die Innovationskraft. Am Standort Dortmund in Nordrhein-Westfalen, im bevölkerungsreichsten Bundesland, kann ELMOS auf eine große Zahl von gut ausgebildeten Jungingenieuren zugreifen, denn im näheren Umkreis befinden sich mehr als fünfzig Universitäten und Hochschulen. Schon seit der Gründung kooperiert ELMOS eng mit diesen und genießt als einziger Halbleiterhersteller der Region eine Ausnahmestellung.

ELMOS hat auch 2006 wieder neue Arbeitsplätze geschaffen. Im Mittel wurden im Geschäftsjahr 2006 konzernweit 1.102 Mitarbeiter im Vergleich zu 1.028 Mitarbeitern in 2005 beschäftigt. Die Neueinstellungen entfielen einerseits auf den Produktionsbereich für den Ausbau des Standorts Duisburg, andererseits wurden auch Entwicklung und Vertrieb an Schlüsselpositio-

nen verstärkt. Zum Jahresende wurden 1.127 Mitarbeiter (2005: 1.050 Mitarbeiter) von den verschiedenen Konzerngesellschaften beschäftigt, davon 738 an den Standorten Dortmund und Duisburg (2005: 673). Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter im ELMOS-Konzern liegt bei 36 Jahren (2005: 36 Jahre).

Rund zehn Prozent der Dortmunder Mitarbeiter sind Auszubildende. ELMOS bildet in zahlreichen kaufmännischen und technischen Berufen aus, mit Schwerpunkt auf dem Beruf des Mikrotechnologen. Ende 2006 befanden sich 70 (2005: 59) der Dortmunder Mitarbeiter in der Ausbildung.

Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Mitarbeitern erfolgt in Dortmund vertrauensvoll und mittels einer Mitarbeitervertretung mit selbst gegebener Satzung. In zahlreichen Ausschüssen werden die Belange der Mitarbeiter untereinander und im Verhältnis zur Geschäftsleitung besprochen und geregelt. So gibt es Ausschüsse für soziale Fragen, Personalangelegenheiten, Mitarbeiterförderung und Wirtschaft.

Mitarbeiterbeteiligung/Aktionsoptionsprogramme

Die Mitarbeiter sind derzeit über Aktionsoptionsprogramme am Erfolg des Unternehmens beteiligt. Diese Programme sehen die Ausgabe von Aktienoptionen an Mitarbeitern unterhalb des Vorstands und zu identischen Bedingungen an den Vorstand vor. Für Tranchen seit 2004 gilt für den Vorstand als zusätzliche Bedingung eine Begrenzung der Wertsteigerung (Cap). Für die Vorstandsmitglieder dienen die Aktienoptionen gleichzeitig als variable Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung.

Zum 31.12.2006 standen insgesamt 715.201 Aktienoptionen (31.12.2005: 843.359) aus den Programmen der Jahre 2000 bis 2004 aus. In 2006 wurden Optionen aus der 2002 beschlossenen und 2003 ausgegebenen Tranche ausgeübt. Dadurch sind 1.381 neue Aktien entstanden. Nähere Informationen zu den verschiedenen Tranchen der Optionsprogramme erhalten Sie unter Textziffer 24 im Anhang zum IFRS-Abschluss.

In den vergangenen beiden Jahren hat der Aufsichtsrat kein neues Aktienoptionsprogramm beschlossen. Vor dem Hintergrund des im Vergleich zur früheren Behandlung nach US-GAAP höheren Aufwands, der sich nach der von IFRS 2 vorgeschriebenen Bilanzierung nach dem beizulegenden Zeitwert (Fair Value) ermittelt, haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, dass andere Maßnahmen zur Incentivierung von Mitarbeitern und Vorständen eingesetzt werden sollen.

Qualität, Sicherheit und Umweltschutz

Im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen setzt ELMOS konsequent seine Null-Fehler-Strategie um und erzielt damit ein hervorragendes automobilgerechtes Qualitätsniveau. Regelmäßige Prüfungen der eingesetzten Werkzeuge, die Betreuung der Serienprodukte von der Entwicklung bis zur Fertigung, ständige Analysen und statistische Verfahren ermöglichen das hohe Qualitätsniveau. Interne Labore prüfen nicht nur mögliche Fehlermechanismen der Halbleiterfertigung, sondern auch sensor- und gehäusespezifische Merkmale.

Konsequente Umsetzung
der Null-Fehler-Strategie

ELMOS betreibt seit Mitte der Neunziger Jahre ein Qualitätsmanagementsystem, das alljährlich gemäß den Anforderungen der DIN ISO 9001 und der Normen QS 9000 und VDA 6.1 auditiert wird. Diese Normen wurden in der ISO/TS 16949: 2002, die weltweite Gültigkeit hat, zusammengefasst. ELMOS Dortmund, ELMOS Advanced Packaging und GED sowie erstmalig auch SMI und die Fertigung in Duisburg wurden in 2006 gemäß dieser Norm auditiert und zertifiziert.

Arbeitssicherheit und Umweltschutz sind neben der Qualität der Produkte und der Wirtschaftlichkeit als gleichrangige Unternehmensziele festgelegt. Zu den Grundsätzen der Umweltpolitik bei ELMOS zählen Rechtskonformität, Minimierung von Umweltbelastungen, Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter, Umweltschutz-Management, kontinuierliche Verbesserung und Kommunikation.

Das Umweltmanagement gemäß DIN EN ISO 14001 wurde am Standort Dortmund in 2003 durch den TÜV Rheinland zertifiziert und in den nachfolgenden Jahren durch Überwachungsaudits ohne Abweichungen bestätigt. Die Bereiche Arbeits- und Umweltschutz sind direkt dem Vorstand unterstellt. Die ISO 14001 verankert den Umweltschutz systematisch und dauerhaft im Management. ELMOS legt beim Umweltmanagement besonderen Wert auf eine effektive Prävention sowie eine effiziente Ausnutzung von Ressourcen.

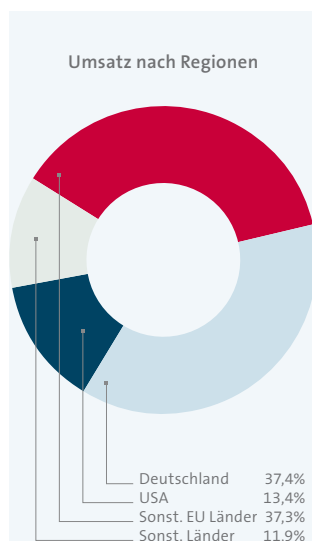
Effektive
Prävention

Neben der Veröffentlichung des Umweltberichts für 2005, der ausführlich über die umweltrelevanten Tätigkeiten, die davon ausgehenden Umweltauswirkungen sowie über die Organisation der Arbeitssicherheit informiert, hat ELMOS ihre hohen sozialen, ökologischen und ökonomischen Ansprüche in einem „Kodex des verantwortungsvollen Handelns“ zusammengefasst. Der Kodex berichtet detailliert über die Verantwortung für das Unternehmen, die Mitarbeiter, die Umwelt und die Gesellschaft. Dieser Verhaltenskodex richtet sich an alle Führungskräfte und Mitarbeiter des ELMOS-Konzerns. Damit wollen wir – für jedermann nachvollziehbar – zu einwandfreiem Verhalten anhalten und mehr Transparenz schaffen. Dieses wird honoriert durch den Kapitalmarkt, indem ELMOS von Kempen Capital Management und SNS Asset Management als Unternehmen prämiert worden ist, welches speziellen Wert auf Umweltfreundlichkeit und soziale Belange legt. Parallel zu der Prämierung ist ELMOS als Kandidat für den Kempen/SNS Smaller Europe Social Responsibility Index ausgewählt worden.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

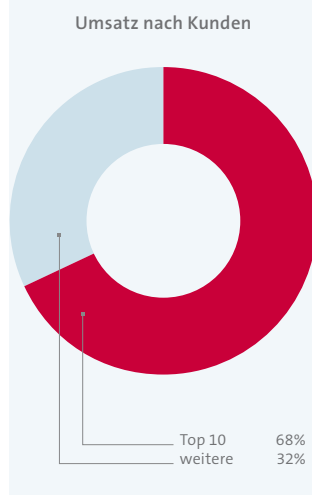
Umsatzentwicklung

Obwohl das Jahr 2006 durch ein schwieriges Marktumfeld gekennzeichnet war, konnte sich die Gesellschaft zufriedenstellend entwickeln. Durch den von Quartal zu Quartal wachsenden Umsatz konnte das angestrebte Umsatzwachstum von zehn Prozent knapp erreicht, aber nicht übertroffen werden. Hier war die Schwäche des US-Automobilmarktes ein wesentlicher Grund, der unsere Erwartungen um rund zehn Prozent verfehlte. Negativ wirkte hier auch der Euro-Dollar-Wechselkurs. Durch die hohen Belastungen aus dem Anlauf der Fertigung in Duisburg, den Vorbereitungen für den Anlauf von Mikrosystemprojekten und dem ungünstigeren Produktmix blieben, wie erwartet, die Margen unter Druck. Zusätzlich mussten die deutlich gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten aufgefangen werden.



Umsatz nach Regionen

Im Berichtsjahr 2006 hat sich die regionale Umsatzverteilung nur geringfügig geändert. Der Deutschland-Anteil hat im Vergleich zum Vorjahr (35,2 Prozent) auf 37,4 Prozent leicht zugenommen; der Anteil der Sonstigen EU-Länder ist auf 37,3 Prozent (2005: 42,9 Prozent) unwesentlich zurückgegangen. Der Umsatzanteil in den USA ist ebenfalls gesunken und beläuft sich auf 13,4 Prozent (2005: 16,6 Prozent). Gerade der rückläufige Umsatz in den USA in der zweiten Jahreshälfte 2006 zeigt die Schwäche des dortigen Marktes. Ein Großteil der Veränderungen resultieren aus der Verschiebung von den Sonstigen EU-Ländern und den USA zu den Sonstigen Ländern. Hier sind vor allem Kanada, China, Mexiko, Schweiz und Taiwan als Länder mit Umsatzzuwachs zu nennen. Die Veränderungen sind teilweise auf den Wechsel einzelner Lieferadressen der Kunden zurückzuführen und nicht gleichbedeutend mit einer Veränderung der Kundenstruktur.



Umsatz nach Kunden

ELMOS beliefert in Summe rund 130 Kunden. Dies sind überwiegend Automobilzulieferer und zu einem kleineren Anteil Industriekunden und KonsumproduktHersteller. In 2006 waren, wie in früheren Jahren, der französische Automobilzulieferer Valeo, die schwedische Autoliv und die Schweizer Saia-Gruppe unsere größten Kunden, die jeweils mehr als zehn Prozent des Umsatzes ausgemacht haben. Der mit unseren größten Kunden getätigte Umsatz verteilt sich in der Regel auf zahlreiche unterschiedliche Produkte, die sich in verschiedenen Stadien ihres Lebenszyklus befinden. Die zehn größten Kunden machten in 2006 rund 68 Prozent (2005: 67 Prozent) oder zwei Drittel unseres Umsatzes aus.

Ertragslage

Bruttoergebnis

Das Bruttoergebnis stieg um 3,4 Prozent auf 73,0 Millionen Euro und damit wie erwartet unterproportional zum Umsatz. Dies erklärt sich vor allem durch die oben genannten Einflussgrößen Rohstoff- und Energiepreise sowie die Anlaufkosten für die Fertigung in Duisburg und die Vorbereitung der Mikrosysteme und ASSPs, wodurch die Herstellungskosten um 14,8 Prozent auf 87,6 Millionen Euro angestiegen sind. Die resultierende Bruttomarge betrug 45,5 Prozent im Vergleich zu 48,1 Prozent in 2005.

Gestiegene
Herstellungskosten

Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen/(Erträgen)

Das Betriebsergebnis sank infolge des schlechteren Bruttoergebnisses um 2,8 Prozent auf 19,6 Millionen Euro und erreichte damit eine Marge von 12,2 Prozent (2005: 13,7 Prozent). Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie für Vertrieb und Verwaltung sind insgesamt von 34,4 Prozent vom Umsatz auf 33,3 Prozent vom Umsatz gesunken. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen sind beeinflusst von der großen Anzahl der sich in der Entwicklung befindlichen Projekte einschließlich der Mikrosysteme und ASSPs sowie von den Entwicklungsarbeiten für die nächste Prozessgeneration. Sie betragen 29,6 Millionen Euro oder 18,4 Prozent des Umsatzes (2005: 19,1 Prozent). Die Aufwendungen für den Vertrieb stiegen auf 9,7 Millionen Euro bzw. 6,0 Prozent vom Umsatz und sind begründet durch die neuen Aktivitäten im Bereich Mikrosysteme und ASSPs. Allgemeine Verwaltungskosten stiegen auf 14,2 Millionen Euro, blieben aber relativ zum Umsatz konstant bei 8,8 Prozent.

EBIT

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hat um 0,9 Prozent auf 19,8 Millionen Euro (2005: 20,0 Millionen Euro) abgenommen und resultierte in einer EBIT-Marge von 12,3 Prozent des Umsatzes (2005: 13,6 Prozent). Das EBIT unterscheidet sich vom Betriebsergebnis durch die zusätzliche Berücksichtigung von Wechselkursverlusten/(-gewinnen), Aufwendungen/(Erträgen) aus assoziierten Unternehmen und Sonstigen betrieblichen Aufwendungen/(Erträgen).

Ergebnis vor Steuern, Konzernüberschuss und Ergebnis pro Aktie

Die Finanzierungserträge/-aufwendungen lagen in 2006 mit 2,5 Millionen Euro klar unter dem Vorjahreswert (2005: 3,6 Millionen Euro). Dies ist insbesondere auf günstigere Refinanzierungszinssätze bei den langfristigen Verbindlichkeiten zurückzuführen. Das Ergebnis vor Steuern erreichte 17,3 Millionen Euro oder 10,8 Prozent vom Umsatz (2005: 16,4 Millionen Euro bzw. 11,2 Prozent). Die Steueraufwendungen sind mit 6,6 Millionen Euro gegenüber 2005 um 0,6 Millionen Euro angestiegen, dabei lag die Steuerquote bei 38,4 Prozent (2005: 37,0 Prozent). Die höhere Steuerquote resultiert im Wesentlichen aus einer Änderung des niederländischen Steuerrechts, wodurch latente Steuern erfolgswirksam wurden. Der Jahresüberschuss nach Abzug der Minderheitenanteile beträgt 10,7 Millionen Euro in 2006 und liegt damit um 6,6 Prozent über dem Vorjahreswert von 10,0 Millionen Euro. Die Nettogewinnmarge erreichte damit mit 6,7 Prozent fast den Vorjahreswert (2005: 6,8 Prozent). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,55 Euro gegenüber 0,52 Euro in 2005.

Vorschlag zur Gewinnverwendung

Die ELMOS Semiconductor AG* erzielte einen Jahresüberschuss von 2,4 Millionen Euro nach HGB. Der Gewinnvortrag nach HGB aus dem Jahr 2005 beträgt 42,5 Millionen Euro. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 10. Mai 2007 vor, den Bilanzgewinn vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Trotz der deutlichen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr sehen Vorstand und Aufsichtsrat im Hinblick auf die langfristige Entwicklung des Unternehmens die Notwendigkeit, die erreichte Liquidität im Unternehmen zu belassen und schlagen vor, keine Dividende auszuschütten, um so auch die notwendigen Investitionen des Jahres 2007 intern finanzieren zu können und keine zusätzlichen Fremdmittel aufnehmen zu müssen.

Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Deutlich gesteigener
Cash Flow

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich um fast 9 Millionen Euro angestiegen. Erheblich dazu beigetragen haben die erreichten Verbesserungen im Nettoumlaufvermögen sowie deutliche Einsparungen bei den Steuerzahlungen. Zudem ist der Anteil der latenten Steuern an der Gesamtsteuerlast um 128 Prozent gestiegen.

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit

ELMOS hat in 2006 die Investitionen weiter zurückgefahren und insgesamt 26,4 Millionen Euro in das Anlagevermögen investiert. Dieser Wert unterschreitet den Vorjahresbetrag (29,6 Millionen Euro) und entspricht rund 16 Prozent des Umsatzes (2005: 20,1 Prozent). Die Investitionen entfielen vor allem auf das Dortmunder Frontend und Backend für Maschinen und Betriebsvorrichtungen sowie auf die Ausstattung des Reinraums am Standort Duisburg. Das Halbleiter-Segment war für den größten Teil der Investitionen verantwortlich, auf die Mikromechanik entfielen 2,6 Millionen Euro. Der im Halbleiter-Segment enthaltene Assembly-Bereich hat in Maschinen zur Fertigung von Spezialgehäusen rund 0,9 Millionen Euro investiert.

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat die in 2006 erforderlichen Investitionen mehr als decken können. Die darüber hinaus zur Verfügung stehende Liquidität wurde hauptsächlich zur Tilgung der langfristigen Verbindlichkeiten genutzt. Die liquiden Mittel stiegen im Berichtsjahr von 11,4 Millionen Euro auf 16,6 Millionen Euro. Der Anteil der liquiden Mittel am Gesamtvermögen beträgt 6,9 Prozent (2005: 4,8 Prozent).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der ELMOS-Gruppe stieg von 237,0 Millionen Euro im Jahr 2005 um 2,1 Prozent auf 241,9 Millionen Euro. Wesentliche Einflussfaktoren waren der Rückgang der latenten Steuerforderungen, die Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten sowie der Anstieg der zur Veräußerung gehaltenen Wirtschaftsgüter. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Erweiterung des Produktionsgebäudes in Dortmund, welches im Jahr 2007 im Zuge einer Sale-and-Lease-back Transaktion veräußert werden soll.

*Der Jahresabschluss der ELMOS Semiconductor AG ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehen. Er wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, ist beim Unternehmensregister hinterlegt und kann als Sonderdruck angefordert werden.

Nettoumlaufvermögen

Die Vorräte stiegen umsatzbedingt von 27,7 Millionen Euro zu Beginn des Berichtsjahres auf 31,1 Millionen Euro am 31. Dezember 2006. Der Anteil der Vorräte am Gesamtvermögen stieg im Vergleich zu 2005 von 11,7 Prozent auf 12,9 Prozent. Dank verbessertem Forderungsmanagement nahmen bei gestiegenen Umsätzen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 4,4 Prozent ab, von 29,1 Millionen Euro auf 27,8 Millionen Euro. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen um 20,4 Prozent von 10,6 Millionen Euro in 2005 auf 12,7 Millionen Euro in 2006.

Passiva

Die Nettoverschuldung sank zum Bilanzstichtag 2006 auf 48,4 Millionen Euro, ein Rückgang um 5,5 Prozent gegenüber dem 31. Dezember 2005. Dies ist im Wesentlichen auf den Rückgang von langfristigen Verbindlichkeiten zurückzuführen.

Prognosebericht

Ausrichtung des Konzerns

ELMOS wird sich zukünftig weiterhin als Nischenanbieter auf kundenspezifische Anwendungen für die Automobilindustrie fokussieren. Um die im Berichtsjahr formulierten Ziele zu erreichen, hat ELMOS an vielen Stellen im Unternehmen teils erhebliche Änderungen in Prozessen, Organisationen und der strategischen Ausrichtung vorgenommen und dem weiteren profitablen Wachstum die Basis bereitet. Dabei sind die ELMOS-Technologie, das ELMOS-Design und die Produktion in der ELMOS-eigenen Fertigung feste Säulen dieser Strategie. Das erfolgreiche automobilen ASIC-Geschäft wird ergänzt durch den Aufbau weiterer Geschäftsfelder. Wir sind überzeugt davon, dass diese Felder mittelfristig entscheidende Wachstums- und Ergebnisbeiträge liefern werden. Insgesamt richten wir den Fokus unserer Arbeit auf weiteres ertragreiches Wachstum. Dieser Prognosebericht basiert auf sorgfältiger Analyse der signifikanten Faktoren.

Folgende Themen werden den Geschäftsverlauf 2007 charakterisieren:

- ▶ Die Erweiterung der neuen 8-Zoll-Fertigung in Duisburg wird in 2007 intensiv betrieben, so dass sie zunehmend signifikante Liefermengen beiträgt. Auf der Kundenseite werden wir verstärkte Anstrengungen unternehmen, um unsere auf 200mm-Wafern gefertigten Produkte in laufende Serien schneller liefern zu können.
- ▶ Wir haben mit der Gründung der Tochtergesellschaft ELMOS Industries das Fundament für ein Wachstum in den Märkten der Industrie- und Konsumelektronik gelegt. Der Umsatzanteil dieser Märkte von derzeit rund zehn Prozent am Gesamtumsatz soll mittelfristig 20 bis 30 Prozent betragen.

- ▶ Wir haben in 2006 sechs applikationsspezifische Standardprodukt-Familien (ASSPs) gestartet. Durch den vermehrten Direktvertrieb solcher Produktreihen und der Unterstützung durch ELMOS Industries können wir die Partnerschaft mit schon vorhandenen Kunden auf weiteren Feldern ausbauen. 2007 werden erste Projekte in Serie gehen.
- ▶ Unsere Mikrosystemprojekte wecken durchweg großes Interesse bei den Kunden. Wir werden mit neuen Produkten im Jahr 2007 beweisen, dass unsere Pionierarbeit auf diesem Feld den Kunden große Vorteile bei ihren Applikationen bringt.
- ▶ Die erweiterte Kooperation mit Freescale Semiconductor für System-in-Package-Solutions eröffnet neue Perspektiven. Die aus dieser Kooperation entstehenden Multi-Chip-Produkte kombinieren die leistungsfähigen 16-Bit Mikrocontroller-Architekturen (MCU) von Freescale mit den applikationsspezifischen Hochvolt-CMOS Chips von ELMOS. Dies hilft uns bei der Entwicklung und Herstellung intelligenter Lösungen für die Komfort- und Karosserieelektronik im Automobil. Im Jahr 2007 werden erste Produkte vorgestellt.
- ▶ Mitte 2006 hat die Verlagerung des Standardgehäuse-Assembly von unserer Tochtergesellschaft in den Niederlanden zu externen Dienstleistern in Asien begonnen, um so Kostenvorteile zu nutzen. Von dem Assembly-Umsatz bei ELMOS AP wurde im vergangenen Jahr bereits mehr als 40 Prozent durch höherwertige Spezialgehäuse erzielt. Nach Abschluss der Verlagerung der Standardgehäuse im zweiten Quartal 2007 wird sich unsere Tochtergesellschaft komplett auf die Entwicklung und Fertigung von Spezialgehäusen konzentrieren.
- ▶ Erste Pilotdesigns in hochintegrierten Logikprozessen mit Foundrypartnern wurden realisiert, um uns so Zugang zu modernsten Technologien zu sichern, ohne eigene, hohe Investitionen in Fertigungseinrichtungen tätigen zu müssen. Im Jahr 2007 wird dieses Projekt mit hohem Engagement weitergeführt.

Die strategischen Ziele werden durch operative Schwerpunktthemen, die unsere Wettbewerbsfähigkeit unterstützen, begleitet. Beispielsweise werden die Programme für erfolgsbezogene Entlohnung in den Bereichen Produktion, Entwicklung und Vertrieb für eine weitere Effizienzverbesserung in den Abläufen sorgen. Von der Einführung einer verbesserten Balanced Scorecard in der Fertigung versprechen wir uns ebenso weitere Kosteneinsparungen. Die Verlagerung der Standardgehäuse nach Fernost wird mittelfristig ebenfalls positive Beiträge zur Ergebnissituation liefern.

Marktsituation

Für das Jahr 2007 sind die Erwartungen des Zentralverbandes der Elektronik-Industrie (ZVEI) für den gesamten Halbleitermarkt gedämpft positiv. Eine Voraussetzung für ein nennenswertes Wachstum wäre eine positive Trendwende, die spätestens mit Ende des ersten Quartals einsetzen muss. Für die Automobilindustrie zeigen die Prognosen keine größere Veränderung in der weltweiten Nachfrage. Die neuen EU-Regeln hinsichtlich des CO₂ Ausstoßes lösen aber die Diskussion über die Berechtigung von Oberklassefahrzeugen aus, die als Innovationsträger der Automobilelektronik in der Vergangenheit wesentliche Impulse gegeben haben. Auf der anderen Seite finden Hybridkonzepte zunehmende Beachtung. So wird der Elektronikanteil je Fahrzeug in jedem Fall auch weiterhin kontinuierlich steigen und der Markt für automobiler Halbleiter weiter wachsen. Für die automobilen Halbleiterchips wird ein durchschnittliches Wachstum von etwa sieben bis acht Prozent bis 2015 prognostiziert.

Die Marktbedingungen haben sich schneller als jemals zuvor geändert. So fordern unsere Kunden wesentlich mehr Unterstützung bei der Integration unserer Chips in ihre Applikationen. Das bedeutet einerseits Mehraufwand, andererseits aber eine Chance zur Marktdifferenzierung. Das gilt vor allem dann, wenn wir patentierte Technologien in unseren Produkten, wie z.B. das neue Konzept zur Ansteuerung von Bürstenlosen-Motoren, namens VirtuHall®, einsetzen.

Das Marktumfeld in den USA wird weiterhin schwierig bleiben. Auch bei den Kosten für Rohstoffe und Energie rechnen wir mit keiner Entlastung in 2007.

Erwartete Finanzlage

Wir bestätigen die Prognose aus Dezember 2006. Dementsprechend rechnen wir mit einem Umsatzanstieg von rund zehn Prozent. Die Bruttomarge wird rund 45 Prozent betragen. Beim EBIT gehen wir von rund zwölf Prozent vom Umsatz aus. Die Zielgröße für das Nettoergebnis ist rund sieben Prozent vom Umsatz. Beim Free Cash Flow wird eine freundliche Entwicklung und dementsprechend ein positives Ergebnis erwartet.

Dortmund, im März 2007

Der Vorstand



Dr. Anton Mindl



Nicolaus Graf von Luckner



Reinhard Senf



Dr. Frank Rottmann

Jahresabschluss

Konzernbilanz nach IFRS

Aktiva	Anhang	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Langfristige Vermögenswerte			
Immaterielle Vermögenswerte	13	39.023.949	34.844.237
Sachanlagen	14	95.556.490	101.959.587
At-Equity bewertete Beteiligungen	15	2	1
Wertpapiere und Anteile	15	126.154	645.795
Latente Steueransprüche	16	4.725.700	9.101.839
Summe langfristige Vermögenswerte		139.432.295	146.551.459
Kurzfristige Vermögenswerte			
Vorratsvermögen	17	31.142.235	27.704.590
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18	27.774.401	29.064.040
Wertpapiere	19	0	5.350.375
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	20	16.634.086	11.418.640
Sonstige Vermögenswerte	21	13.586.114	10.937.674
		89.136.836	84.475.319
Vermögenswerte einer Veräußerungsgruppe, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert wird	22	13.343.658	5.997.193
Summe kurzfristige Vermögenswerte		102.480.494	90.472.512
Bilanzsumme		241.912.789	237.023.971

Passiva	Anhang	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Eigenkapital			
Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital			
Grundkapital	23	19.413.805	19.412.424
Kapitalrücklage	23	88.733.815	88.270.716
Gewinnrücklage		102.224	102.224
Kumulierte erfolgsneutrale Veränderung des Eigenkapitals	23	-4.991.418	-2.943.060
Bilanzgewinn		49.091.408	38.912.998
		152.349.834	143.755.302
Minderheitenanteil		505.088	528.190
Summe Eigenkapital		152.854.922	144.283.492
Schulden			
Langfristige Schulden			
Rückstellungen	25	1.142.637	1.121.704
Finanzverbindlichkeiten	26	28.284.983	32.864.259
Sonstige Verbindlichkeiten	27	354.307	1.488.110
Summe langfristige Schulden		29.781.927	35.474.073
Kurzfristige Schulden			
Rückstellungen	25	5.122.981	4.392.625
Steuerverbindlichkeiten	27	280.169	1.245.929
Finanzverbindlichkeiten	26	36.712.756	35.060.684
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28	12.731.544	10.574.161
Sonstige Verbindlichkeiten	27	4.428.490	5.993.007
Summe kurzfristige Schulden		59.275.940	57.266.406
Summe Schulden		89.057.867	92.740.479
Bilanzsumme		241.912.789	237.023.971

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS

	Anhang	2006 Euro	2005 Euro
Umsatzerlöse	5	160.673.887	146.963.437
Umsatzkosten	6	87.629.925	76.336.529
Bruttoergebnis		73.043.962	70.626.908
Forschungs- und Entwicklungskosten	6	29.583.236	28.124.440
Vertriebskosten	6	9.679.254	9.409.620
Verwaltungsaufwendungen	6	14.216.140	12.970.297
Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen/(Erträgen)		19.565.332	20.122.551
Finanzierungserträge	8	– 452.319	– 3.973.355
Finanzierungsaufwendungen	8	2.954.883	7.588.365
Wechselkursverluste/(-gewinne)	9	288.115	– 193.744
Aufwendungen (Erträge) aus assoziierten Unternehmen		48.999	67.636
Sonstige betriebliche Erträge	10	– 4.176.926	– 2.051.664
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10	3.581.829	2.294.635
Ergebnis vor Steuern		17.320.751	16.390.678
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteueraufwand	11	1.185.589	3.663.913
Latente Steuern	11	5.458.781	2.394.482
		6.644.370	6.058.395
Konzernüberschuss		10.676.381	10.332.283
Davon entfallen auf:			
Minderheitenanteile		– 18.291	296.456
Anteilseigner des Mutterunternehmens		10.694.672	10.035.827
Ergebnis je Aktie			
Unverwässertes Ergebnis je Aktie	12	0,55	0,52
Voll verwässertes Ergebnis je Aktie	12	0,55	0,52

Konzern-Kapitalflussrechnung

	Anhang	2006 Euro	2005 Euro
Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit			
Konzernüberschuss nach Minderheitenanteilen		10.694.672	10.035.827
Abschreibungen		16.287.270	15.499.930
Latente Steuern		5.458.781	2.394.482
Ertragsteueraufwand		1.185.589	3.663.913
Minderheitenanteile		- 18.291	296.456
Aufwand/Ertrag aus der Bewertung „at equity“		48.999	67.636
Veränderung der Pensionsrückstellungen		20.933	- 416.888
Aufwand aus Aktienoptionsprogramm		453.611	1.289.725
Veränderungen im Netto-Umlaufvermögen:			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.296.722	- 1.286.139
Vorräte		- 3.437.645	- 2.556.856
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte		- 1.907.421	- 5.059.327
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.157.383	- 465.063
Sonstige Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten		- 834.160	2.775.504
Ertragsteuerzahlungen		- 2.886.707	- 6.565.582
Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit		28.519.736	19.673.618
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit			
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte		- 9.578.886	- 7.006.925
Investitionen in das Sachanlagevermögen		- 16.772.554	- 22.604.502
Investitionen in zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte		- 7.346.464	- 4.631.966
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		10.198.918	4.070.876
Erwerb/Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens		3.629.862	42
Erwerb/Abgang von Beteiligungen		- 45.723	- 244.296
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit		- 19.914.847	- 30.416.771
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit			
Gezahlte Dividenden		0	- 4.053.000
Einzahlung aus Kapitalerhöhung		10.868	884.777
Gewinnausschüttung durch konsolidierte Tochtergesellschaft an Minderheitsgesellschafter		0	- 270.000
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten		325.000	0
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten		- 5.674.655	- 3.852.822
Aufnahme/Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.266.460	14.029.988
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit		- 4.072.327	6.738.943
Abnahme/Zunahme der liquiden Mittel		4.532.562	- 4.004.210
Effekt aus Wechselkursänderungen der liquiden Mittel		682.884	136.255
Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres		11.418.640	15.286.595
Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres	20	16.634.086	11.418.640

Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals nach IFRS

	Aktien Stück	Grundkapital Euro	Kapitalrücklage Euro
Stand 1. Januar 2005	19.300.000	19.300.000	86.208.638
Dividendenausschüttung			
Aufwand aus Aktienoptionen			1.289.725
Ausübung von Optionen	112.424	112.424	772.353
Nicht realisierte Gewinne aus Wertpapieren des Umlaufvermögens nach Steuern			
Währungsveränderungen			
Erwerb Minderheitenanteile ELMOS France			
Jahresüberschuss 2005			
Stand 31. Dezember 2005	19.412.424	19.412.424	88.270.716
Aufwand aus Aktienoptionen			453.611
Ausübung von Optionen	1.381	1.381	9.487
Nicht realisierte Gewinne aus Wertpapieren des Umlaufvermögens nach Steuern			
Währungsveränderungen			
Änderung des Konsolidierungskreises			
Jahresüberschuss 2006			
Stand 31. Dezember 2006	19.413.805	19.413.805	88.733.815

Gewinnrücklagen Euro	Kumulierte erfolgsneutrale Veränderung des Eigenkapitals Euro	Bilanzgewinn Euro	Gesamt Euro	Minder- heitenanteil Gesamt Euro	Konzern Gesamt Euro
102.224	- 5.307.063	32.930.171	133.233.970	592.427	133.826.397
		- 4.053.000	- 4.053.000	- 270.000	- 4.323.000
			1.289.725		1.289.725
			884.777		884.777
	1.211.241		1.211.241		1.211.241
	1.152.762		1.152.762		1.152.762
				- 90.693	- 90.693
		10.035.827	10.035.827	296.456	10.332.283
102.224	- 2.943.060	38.912.998	143.755.302	528.190	144.283.492
			453.611		453.611
			10.868		10.868
	- 1.211.241		- 1.211.241		- 1.211.241
	- 837.117		- 837.117		- 837.117
		- 516.262	- 516.262	- 4.811	- 521.073
		10.694.672	10.694.672	- 18.291	10.676.381
102.224	- 4.991.418	49.091.408	152.349.834	505.088	152.854.922

Finanzkalender

14.03.2007	Bilanzpressekonferenz ELMOS Dortmund
14.03.2007	Analystenkonferenz DVFA, Frankfurt am Main
08.05.2007	Zwischenbericht Januar bis März 2007
10.05.2007	Hauptversammlung Casino Hohensyburg, Dortmund
01.08.2007	Zwischenbericht Januar bis Juni 2007
31.10.2007	Zwischenbericht Januar bis September 2007

Kontakt

ELMOS Semiconductor AG
Heinrich-Hertz-Straße 1
44227 Dortmund
www.elmos.de

Investor Relations

Telefon +49 (0) 231-75 49-287
Telefax +49 (0) 231-75 49-548
invest@elmos.de

Den vollständigen Geschäftsbericht
können Sie bei oben genannter
Kontaktadresse kostenlos anfordern
oder auf unserer Homepage
herunterladen.